

LPKF

Laser & Electronics



LASERS FOR THE WORLD OF ELECTRONICS

**LPKF**  
Laser & Electronics

## Zahlen und Fakten im Überblick

Die LPKF Laser & Electronics AG, Garbsen bei Hannover, zählt international zu den Marktführern auf dem Gebiet lasergestützter Anwendungstechnologien für die moderne Mikroelektronik. Durch Kompetenz, Know-how und Qualitätsbewußtsein hat sich das Unternehmen

im Laufe seiner 25-jährigen Geschichte mit überzeugenden Lösungen und ausgereiften Produkten weltweit einen erstklassigen Ruf bei bedeutenden Kunden und Forschungseinrichtungen aufgebaut.



Neue LPKF Hauptverwaltung



Empfang

- 1976 Gründung LPKF und Einführung der ersten Prototyping Systeme
- 1980 Zweigstellengründung USA
- 1984 Einführung eines Prototyping-Komplettsystems (inkl. CAD-Programm)
- 1989 Einstieg in die Lasertechnologie, mit dem Ziel des wirtschaftlichen Einsatzes von Lasertechnologien für die Mikroelektronik
- 1991 Bau und Einzug in das neue Firmengebäude in Garbsen  
Einstieg in die Antriebstechnologie durch Gründung der LPKF Motion & Control
- 1993 Entwicklung der StencilLaser
- 1994 Gründung LPKF Slowenien
- 1996 Entwicklungsprojekte: 3D-MID und Chip Size Packaging
- 1997 Erster Prototyp MicroLine Laser
- 1998 Umwandlung in AG und Börsengang
- 1999 Kooperationsabkommen mit Atotech Deutschland GmbH und MANIA Technologie AG im Dezember
- 2000 Entwicklung des MicroLine Drill Lasersystems zum Bohren und Strukturieren von Leiterplatten

<b>Konzern-Kennzahlen im Überblick</b>	2000	1999	1998
Umsatz (in Mio. DM)	54,8	38,6	31,9
EBIT	12,3	9,5	8,1
Cash-flow	10,8	7,6	5,4
Sachinvestitionen	10,3	5,6	2,5
Gewinn je Aktie (in DM) - unverwässert -	0,59	0,42	0,38
<b>Umsatz nach Ländern (in Mio. DM)</b>			
Inland	14,0	8,5	8,4
übriges Europa	9,7	8,1	8,3
Nordamerika	15,5	11,4	7,6
Asien	14,1	10,1	7,3
Sonstige	1,5	0,5	0,3
<b>Umsatz Produkte (in Mio. DM)</b>			
Laser	27,8	17,2	15,6
Rapid Prototyping	20,9	17,1	13,4
Schablonen	3,9	3,4	2,1
Sonstiges	2,2	0,9	0,8
Mitarbeiter	186	122	92

Karl Jaspers

Die Zukunft ist als Raum der Möglichkeiten der Raum unserer Freiheit.

aser & Electronics

Grußwort des Vorstandsvorsitzenden	④
Bericht des Aufsichtsrates	⑧
Lagebericht des LPKF-Konzerns	⑩
Wachstumsmarkt Elektronik Tagebuch einer Innovation	⑱ ⑳
Gewinn- und Verlustrechnung	⑳
Konzernbilanz	㉑
Kapitalflussrechnung	㉒
Konzernanhang	㉓
Jahresabschluss 2000	㉔



Der LPKF-Vorstand (von links): Dr. Jorg Kickelhain (Forschung und Entwicklung), Bernd Hildebrandt (Vorstandsvorsitzender), Dipl.-Ing. Bernd Hackmann (Produktion, Vertrieb und Marketing)



Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre ...

# Grüßwort des Vorstandsvorsitzenden



Bernd Hildebrandt

Das Jahr 2000 war auch für die LPKF Laser & Electronics AG von entscheidender Bedeutung: Wir hatten uns für dieses zweite Geschäftsjahr unseres Unternehmens als Aktiengesellschaft die Markteinführung neuer Lasersysteme vorgenommen. Diese Systeme sollen den Wachstumsschub der kommenden Jahre garantieren. Heute bereits können wir feststellen, dass wir unser Ziel tatsächlich auch weitestgehend erreicht haben. Unsere Umsatzbilanz zeigt nicht nur weiter wachsende Verkaufszahlen bei den Segmenten Rapid Prototyping und StencilLaser – erstmals erscheinen darüber hinaus auch völlig neue Produkte in dieser Aufstellung: MicroLine Laser für die flächige Strukturierung von Feinleiterschaltungen, MicroLine Drill zum Bohren und Strukturieren, Polymer StencilLaser, FlexRouter (aus der Kooperation mit der Mania AG), ProtoLaser für die Feinstrukturierung im Labor sowie Scan-Check für die Automatische Optische Inspektion (AOI) von Stencils.

Wir haben unser selbst gestecktes und freiwillig erhöhtes Leistungsziel erreicht. Sicherlich wäre bei dem einen oder anderen Produktsegment auch eine noch höhere Verkaufszahl wünschenswert gewesen. Viel wichtiger für uns ist und war aber, dass wir unsere Marktakzeptanz bewiesen haben. Und das bedeutet auch, dass wir mit unseren hochinnovativen Produkten für 2001 und die

Folgejahre bestens gerüstet sind. Unsere Systeme treffen haargenau den Hauptnachfrage-trend des Elektronikmarktes: immer kürzere Produktlebenszyklen, die überwiegend in Feinleitertechnik hergestellt werden müssen. Unsere Marschrichtung ist klar: Mit neuen Prozessen Marktführer werden, die Marktführerschaft über Jahre hinaus sichern und die Produkte mit einer guten Marge zu verkaufen. Und dafür wünschen wir uns weiterhin Ihr Vertrauen.

LPKF kann in diesem Jahr auf eine 25jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Mit Stolz kann auch ich für mich in Anspruch nehmen, die Geschicke dieses Unternehmens und seiner Mitarbeiter an verantwortlicher Stelle in diesem Vierteljahrhundert mit geprägt zu haben. Dies schließt auch den Gang an die Börse, den Neuen Markt mit ein. Und da haben ja gerade die letzten Monate gezeigt, auf welcher solider Basis dieses Unternehmen steht: Da wo andere bis zu 90 Prozent ihres Wertes verloren haben, wo es in Einzelfällen auch Insolvenzen gegeben hat, ist LPKF nahezu unbeschädigt über die Runden gekommen. Die Gründe dafür sind offenkundig: zum einen sind unsere Mitarbeiter, unser wichtigstes Kapital, eng mit dem Unternehmen verbunden und zum anderen verfügen wir über ein zukunftsweisendes Potenzial an innovativen Produkten, das seinesgleichen sucht.

Dieser Erfolg ist hart erkämpft worden. In den letzten 12 Monaten habe ich meine Arbeit verstärkt auf strategische Planungen und Beziehungen zu Investoren konzentriert. Um diese noch erfolgreicher gestalten zu können, werde ich mich ganz aus dem operativen Tagesgeschäft als Vorstandsvorsitzender zurückziehen, um dann als Aufsichtsratsvorsitzender in dieser Hinsicht noch effektiver wirken zu können.

Wir haben bei LPKF ja von vornherein und anders als bei den meisten anderen deutschen Unternehmen, den Aufsichtsrat nach dem amerikanischen Board-Modell frühzeitig in die unternehmerische Entscheidung mit einbezogen. Das hat sich Dank des bisherigen Aufsichtsrats-Vorsitzenden Klaus Sülter auch bewährt. Diesen aktiven und nicht nur „Aufsicht führenden“ Aufsichtsrat wollen wir durch meinen Schritt noch verstärken. Für den Vorstand sind, wie Sie wissen, personell die Weichen bereits gestellt worden – in aller Ruhe und zukunftsweisend. Meine Familie und ich sind dem Unternehmen seit langem verbunden – und das wollen wir auch weiter bleiben. Ich freue mich auf weitere gute Zusammenarbeit!

Mit freundlichen Grüßen  
  
 Bernd Hildebrandt,  
 Garbsen, März 2001

LPKF Laser & Electronics AG, Garbsen · 10.500.000 EUR	
LPKF d.o.o., Kranj, Slowenien, 1.500.000 SIT · 75%	LPKF Laser & Electronics Inc., Wilsonville, Oregon/USA, 100 US \$ · 60%
LPKF Motion & Control GmbH, Suhl, Thüringen, 192.000 DM · 50,94%	LPKF, Franklin Industries N.V., Mechelen, Belgien, 9.980.000 BF · 100%
ELASER GmbH, Suhl, Thüringen, 50.000 DM · 100%	LPKF Laser & Electronics France, Lisses, Frankreich, 50.000 EUR · 94%
A-LASER, Beaverton, Oregon/USA, 250.000 US \$ · 20% / 80%	LPKF Tianjin Co., Ltd, China, 600.000 EUR · 100%
LPKF Laser Components GmbH, Garbsen, 25.000 EUR · 80%	LPKF Properties LLC, Wilsonville, Oregon/USA, 100 US \$ · 60%
Laserquipment AG, Erlangen, 50.000 EUR · 19,99%	PhotonicNet GmbH, Hannover, 27.500 EUR · 9,09%

- Bericht des Aufsichtsrates
- Lagebericht des Konzerns
- Wachstumsmarkt Elektronik
- Tagebuch einer Innovation
- Gewinn- + Verlustrechnung
- Konzernbilanz
- Kapitalflussrechnung
- Konzernanhang
- Jahresabschluss 2000



Perspektiven für die Zukunft ...



## Bericht des Aufsichtsrates



Forschung und Entwicklung

*Der Aufsichtsrat legt hiermit seinen 3. Bericht seit dem Bestehen unserer Gesellschaft als Aktiengesellschaft vor.*

Im Berichtszeitraum fanden fünf formelle Sitzungen statt. Hauptgegenstand waren die Berichte des Vorstands zur Lage des Unternehmens, die, durch entsprechendes Zahlenmaterial untermauert, vom Vorstand im Einzelnen dargelegt wurden. In offener Diskussion wurden Probleme und Fragestellungen von entsprechender Relevanz auf ihre Auswirkungen auf das Unternehmen hin diskutiert. Die notwendigen Beschlüsse wurden einstimmig gefasst. Daneben hat der Aufsichtsrat in zahlreichen Einzelfällen den Vorstand bei Fragestellungen über die zukünftige strategische Weiterentwicklung der LPKF AG unterstützt.

Durch Kooperationen, das Eingehen strategischer Allianzen, oder auch den Erwerb einzelner Unternehmungen beabsichtigt der Vorstand ein kontrolliertes Wachstum auf Basis des Kerngeschäfts. Dieses wurde durch den Aufsichtsrat in Verhandlungen mit potenziellen Partnern engagiert unterstützt.

Ebenso erfolgreich und für das Unternehmen wertvoll waren die Gespräche des Aufsichtsrats und Vorstands mit Fondsmanagern und Analysten anlässlich sogenannter „Road-Shows“.

Die sachliche und fundierte Erläuterung der veröffentlichten Daten dieser Personengruppe ist wichtig, da ihre Anlageempfehlungen von einem großen Kreis von Kapitalanlegern befolgt werden. Auch hier fühlt sich der Aufsichtsrat nach entsprechender Abstimmung angesprochen, den Vorstand nicht nur in Sitzungen, sondern auch durch Teilnahme an solchen Verhandlungen aktiv zu unterstützen.

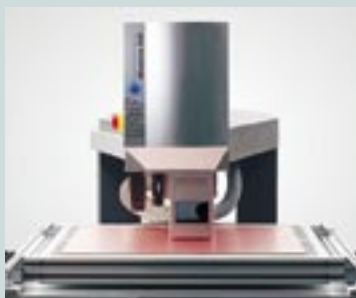
Wie auch an anderer Stelle berichtet, haben die Kooperationen mit Hochschulen beachtliche Erfolge gebracht. So haben die Universität Erlangen und die Fachhochschule Lemgo in Zusammenarbeit mit LPKF zahlreiche Forschungsvorhaben abgewickelt bzw. geplant.

Wir betrachten die enge Zusammenarbeit mit renommierten Hochschulen im Bereich der Forschung als eine Auszeichnung für unser Unternehmen und als Herausforderung, den angestrebten Wissenstransfer von der Theorie zur Praxis zu realisieren.

Der Aufsichtsrat misst der Forschung & Entwicklung große Bedeutung bei. Wir sehen durch Kooperationen große Chancen, die Marktführerschaft bzw. starke Position am Markt und die Wertschöpfung in unserem Unternehmen auch für die Zukunft zu sichern.

Bereits im vorjährigen Geschäftsbericht hat der Aufsichtsrat seinen festen Willen bekundet, die bis dahin praktizierte enge, vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand nicht nur fortzusetzen, sondern nach Möglichkeit noch zu intensivieren und zu verbessern.

Kontrolliertes Wachstum ...



LPKF MicroLine Drill



Messestand auf der electronica2000 in München



LPKF MicroLine Laser

Der Aufsichtsrat war sich bewusst, dass das „LPKF-Modell“ sowohl von der interessierten Öffentlichkeit als auch von den Aktionären beobachtet werden würde.

Die Zusammenarbeit beider Organe gewinnt offenkundig an Bedeutung.

Dies heißt aber auch, dass das Aufsichtsratsmandat kein Ehrenamt mehr ist. Mehr und mehr gewinnt die Einsicht an Bedeutung, dass es für diese Aufgabe anerkannter Fachleute bzw. hochqualifizierter Manager bedarf, die im Verein mit dem Vorstand dieser Herausforderung gewachsen sind. Wenn die international tätige und angesehene Managementberatungsgesellschaft Heidrick & Struggles feststellt, es handelt sich um eine professionelle Aufgabe, bei der es gilt, ungenutzte Managementressourcen im Aufsichtsrat für das Unternehmen zu aktivieren, so können wir dem nur zustimmen und auf die bei uns geübte Praxis verweisen.

Die Entwicklung des Vorstands und des Aufsichtsrats nach deutschem Recht zu einem dem amerikanischen „Board“ entsprechenden Leitungsgremium ist unverkennbar, insbesondere bei Unternehmen mit institutionellen Großanlegern.

Der Wandel vollzieht sich zwar langsam, wir glauben jedoch, auf diesem Weg bereits ein gutes Stück vorangekommen zu sein. Die Richtlinien, die das Zusammenwirken von Verwalt-

ung und Aufsichtsgremien normieren, sind mit dem KonTraG noch nicht abschließend geregelt. Das bei uns wie bereits bei anderen Unternehmen praktizierte System mag einen kleinen Anstoß dazu geben.

In Wahrnehmung seiner gesetzlichen Pflichten hat der Aufsichtsrat der Societäs Treuhand Gruppe GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, am 21.12.2000 den Prüfungsauftrag für den Jahresabschluss 2000 erteilt. Dieser Abschluss ist inzwischen geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehen worden.

Der Abschlussprüfer seinerseits hat an der entscheidenden Sitzung des Aufsichtsrates vom 14.03.2001 teilgenommen und über die Prüfung des Jahresabschlusses berichtet sowie auf Wunsch ergänzende Auskünfte erteilt.

Den gesetzlichen Vorschriften folgend hat der Aufsichtsrat dann seinerseits Jahresabschluss, Lagebericht und Gewinnverwendungsvorschlag geprüft, und somit den Jahresabschluss gebilligt. Er ist nunmehr festgestellt.

Ebenfalls gebilligt wurde der Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von DM 7.061.191,47: Ein Teilbetrag von DM 1.260.000 wird zur Ausschüttung einer Dividende von DM 0,12 je dividendenberechtigter Stückaktie verwendet, der verbleibende Bilanzgewinn von DM 5.801.191,47 auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Konzernabschluss, der Bericht über die Lage des Konzerns und der Bericht des Konzernabschlussprüfers haben bei den Beratungen mit dem Vorstand und den Abschlussprüfern vorgelegen. Sie sind in die Prüfung mit einbezogen und zustimmend zur Kenntnis genommen worden.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand, dem Betriebsrat und allen Mitarbeitern für ihren Einsatz im Unternehmen und die geleistete Arbeit. Ohne diesen Einsatz wäre LPKF nicht das, was es heute darstellt, nämlich eine „Perle des Neuen Marktes“, wie sie von den Aktionärsschutzgemeinschaften auf der letztjährigen Hauptversammlung bezeichnet wurde.

Garbsen, 14. März 2001

Für den Aufsichtsrat

Klaus Sülter  
-Vorsitzender-

# Lagebericht des LPKF-Konzerns

## *Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft*

Der Elektronikmarkt war auch im Berichtsjahr ein wesentlicher Wachstumsmotor der weltweiten Konjunktur. Ganz besonders der Mobiltelefon-Markt hat hier seine Erfolgsgeschichte fortgesetzt. Nach Einschätzung des VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagebau e.V.) wird für die gesamte Elektronikindustrie ein Marktvolumen von US \$ 1,34 Billionen bis 2004 erwartet.

Als Indikator für LPKF kann der weltweite Leiterplattenmarkt zugrunde gelegt werden. Dieser wuchs pro Jahr nach vorläufigen Informationen durchschnittlich um acht Prozent. Für 2000 liegen noch keine exakten Daten vor, doch gilt als sicher, dass das Jahr 2000 der Leiterplattenindustrie einen Rekordzuwachs bescherte. Für 2001 wird ein gedämpfterer Verlauf erwartet. Dennoch wird ein weltweit gutes Jahr laut VDMA prognostiziert. Wesentliche Wachstumsmotoren sind jetzt und auch in der Zukunft die Bereiche Telekommunikation, Datentechnik und Kfz-Elektronik.

Ein klarer Trend geht hin zu Produktionstechniken für neue Halbleitergenerationen. Der verstärkte Einsatz von CSPs (Chip Size Packaging) wird den Bedarf an HDI (High Density Interconnect)-Schaltungen noch beschleunigen. Hieraus erwachsen besonders für die MicroLine-Familie von LPKF signifikante Marktchancen.

Die Entwicklungsdynamik in der Elektronik verlangt nach permanenten Neuentwicklungen. So hat sich der Innovationszyklus eines Mobilfunk-Telefons auf ein halbes Jahr reduziert. Der Faktor „time-to-market“ hat zunehmend an Bedeutung gewonnen.

Hieraus ergeben sich sehr gute Marktchancen für LPKF im Rapid Prototyping Bereich. Dabei wird der von LPKF verfolgten Produktstrategie, den Markt als Systemlieferant zu bedienen, eine besondere Bedeutung beigemessen.

## *Umsatz- und Auftragsentwicklung*

Die Umsatzentwicklung im Bereich Rapid Prototyping verlief im Berichtsjahr mit einem Zuwachs von 22,1 Prozent erfolgreich. LPKF ist in diesem Segment Systemlieferant und hat erhebliche Verbesserungen im Sortiment realisiert. Die neuen Produkte sind sehr gut vom Markt aufgenommen worden und haben wesentlich zum Wachstum im Bereich Rapid Prototyping beigetragen. Der ProtoLaser, eine Kombination der Lasertechnologie mit dem Fräsbohrplotter, hat durch erste Verkäufe Marktakzeptanz erzielt. Hiermit kann bereits bei der Herstellung des Prototyps eine Feinststrukturierung von 40-50 µm erreicht werden.

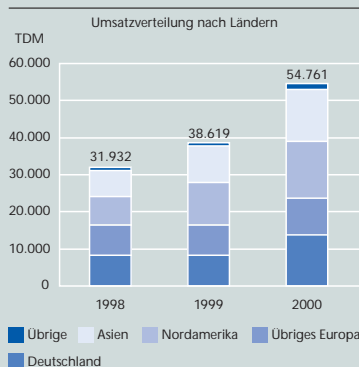
Die Umsätze im Bereich Lasersysteme sind um 61,7 Prozent gewachsen. Hier haben die ersten realisierten Verkäufe der neuen Produktlinien wie MicroLine Laser-Familie, Polymer StencilLaser, FlexRouter, ScanCheck und MicroLine Drill zum sehr guten Erfolg des Segments geführt. Unmittelbar nach der Vorstellung des neuen MicroLine Drill-Systems auf der „electronica2000“ in München konnten zwei Maschinen verkauft werden.

Diese Neuentwicklung bietet als kombiniertes Microviabohr- und Strukturierungssystem Problemlösungen für mittlere Leiterplattenlosgrößen. Im Berichtsjahr 2000 wurden über alle Segmente acht Neuentwicklungen dem Markt vorgestellt.

Innovationen mit System ...

Sie haben sofort zu Verkäufen geführt. Diese jungen Produkte haben wesentlich das Wachstum getragen.

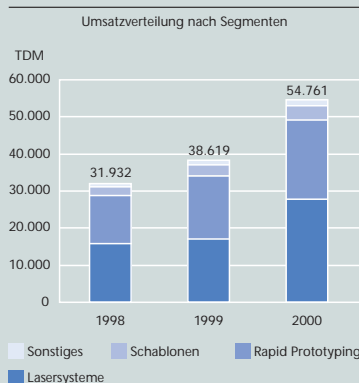
Die Umsatzverteilung nach Ländern ist ausgewogen und beinhaltet eine gute Risikoverteilung. Es gibt weder Abhängigkeiten von Ländern noch von Großunternehmen als Großkunden.



### Produktion und Beschaffung

Die LPKF Slovenia d.o.o./Kranj ist der Hauptlieferant für Fräsbohrplotter, Laserquellen und das ScanCheck System. Die Produktionsbreite wurde gezielt erweitert, um zusätzliche Synergien zur Herstellkostenoptimierung abzuschöpfen. Die weltweiten Beschaffungspreise sind aufgrund der hohen Nachfrage gestiegen.

Weiterhin haben sich die Wiederbeschaffungszeiten für Bauteile erhöht. Die Steigerung der Materialeinsatzquote resultiert aus Veränderungen im Produktmix, ist aber auch auf Preiserhöhungen weltweit beschaffter Komponenten zurückzuführen.



Kompensierend wirkt sich hier die Produktion aus dem Tochterunternehmen in Slowenien aus. Das hohe Umsatzwachstum, resultierend aus der Innovationsdynamik und dem damit verbundenen sehr viel höheren Materialdurchsatz im Unternehmen, konnte durch die eingeleiteten Kapazitätserweiterungen im vollen Umfang realisiert werden.

Die Einführung des Qualitätsmanagementsystems DIN EN ISO 9001:2000 ist im vollen Gange. Erste Teilbereiche des Systems finden bereits erfolgreich Anwendung. Das Zertifizierungsaudit für das Gesamtsystem ist im III. Quartal 2001 geplant.

### Investitionen

Im Herbst 2000 wurde der Neubau am Stammsitz in Garbsen bezogen. Die Investitionen lagen bei 3.945 TDM. Weiterhin wurde eine Kapazitätserweiterung bei LPKF Motion & Control in Suhl realisiert. Hier betrug die Investitionssumme 2.700 TDM.

Für das Geschäftsjahr 2001 sind Investitionen schwerpunktmäßig im Bereich F&E-Lasersysteme geplant. Hier geht es um die konsequente Fortsetzung der Innovationsdynamik, um kundenorientierte Produkte schnell auf den Markt bringen zu können. Kontinuierliche Investitionen fließen ebenfalls in den Bereich Rapid Prototyping, um weiterhin technologisch auch in diesem Segment Vorreiter zu bleiben.

In China wurde die LPKF Tianjin Co. Ltd. als hundertprozentige Tochter gegründet.

Die LPKF Laser & Electronics AG hat sich mit 19,9 Prozent am Grundkapital der Laserquipment AG beteiligt. Ferner hat sich die LPKF mit 9,09 Prozent an der PhotonicNet GmbH beteiligt.



Entwicklung

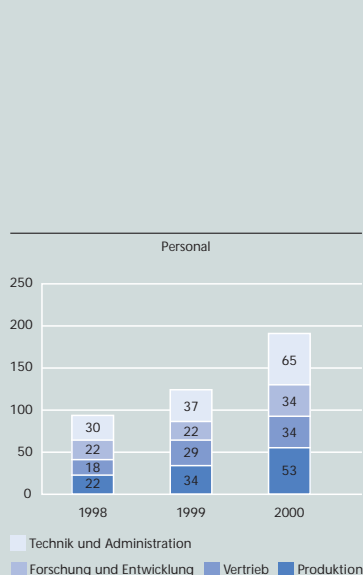
### Finanzierungsmaßnahmen

Aus der Liquidität wurden sämtliche Kosten und Investitionen im Bereich F&E beglichen sowie die Neubaueinrichtung in Garbsen. Das Gleiche gilt für die Übernahme von Firmenanteilen bzw. Kapitalanlagen für Neugründungen: LPKF Tianjin Co. Ltd., Laserquipment AG und PhotonicNet GmbH.

Die Neubauten in Garbsen und Suhl wurden durch langfristige Kredite fremdfinanziert.

### Personalbereich

Im Berichtsjahr 2000 wurde das Personal stichtagsbezogen zum Jahresende von 122 auf 186 aufgestockt. Die Zuwächse lagen in den Bereichen Produktion, Vertrieb/Marketing, F&E und Technik/Administration.



---

### **Lage der verbundenen Unternehmen**

---

#### **Elaser GmbH**

Die Umsätze in 2000 reduzierten sich im Vergleich zu 1999 um 13,8 Prozent bei guter Umsatzrentabilität. Diese Entwicklung entsteht aus der strategischen Rolle des Unternehmens, das die Stencilfertigung in Dienstleistung übernimmt, bis der Kunde einen eigenen StencilLaser kauft. In 2001 sollte ein Umsatz auf etwas gesteigertem Niveau möglich sein.

---

#### **A-Laser Inc. in den USA**

Die Gesellschaft hat die geplanten Ziele erreicht und ist heute auf dem nordamerikanischen Markt ein wichtiger Dienstleister rund um die Stencil-Technologie.

---

#### **LPKF Motion & Control GmbH**

Das neue Gebäude (Gesamtinvestitionsvolumen 2.700 TDM) ist im Berichtsjahr 2000 bezogen worden. Mit dieser Kapazitätserweiterung konnte die Firma den Produktionsplan voll erfüllen. Die Entwicklung ist durch die Einstellung neuer Mitarbeiter intensiviert worden. Für die Qualitätssicherung von sehr komplexen Schablonen für die Leiterplattenfertigung ist ein neues System entwickelt und produziert worden. In 2001 wurden hierfür erste Verkäufe realisiert. Zur Zeit sind neue Steuerungssysteme sowie Antriebe für den Bereich Rapid Prototyping und Lasersysteme in Arbeit. Die Gesellschaft hat durch die sehr hohe Kompetenz in Antriebs- und Steuerungstechnik einen wichtigen Beitrag für den weltweiten Erfolg der LPKF geleistet.

---

#### **LPKF d.o.o. in Slowenien**

Die Qualität der gelieferten Fräsbohrplotter Systeme konnte durch in Slowenien erfolgte Neukonstruktionen erheblich verbessert werden.

Außerdem konnten die Herstellungskosten durch Synergien optimiert werden. Die Entwicklung und Produktion der Laserquellen für die StencilLaser und den MicroLine Drill wurde erfolgreich realisiert. Besonders beim MicroLine Drill werden hier technologisch völlig neue Wege beschritten, die LPKF deutliche Vorteile am Markt verschaffen. Bei der Gründung der Gesellschaft im Jahre 1994 wurde der Standort in einem steuerbegünstigten Gebiet gewählt. Der nachträgliche Widerruf der Steuerbegünstigung führte zu einer hohen Steuernachzahlungsforderung. Der Konzern hält die Nachforderung für ungerechtfertigt und hat in 1999 gerichtliche Schritte eingeleitet. Dieses Verfahren ist auch im Berichtsjahr noch nicht abgeschlossen.

---

#### **LPKF Laser Components GmbH**

Diese Gesellschaft wurde 1999 gegründet, um in Zusammenarbeit mit einem Partner in Russland den Know-how-Transfer im Bereich der Lasertechnik zu ermöglichen. Die Aktivitäten sind in 2000 wie geplant angelaufen.

---

#### **LPKF Laser & Electronics Inc. in den USA**

Die Gesellschaft agiert als Vertriebs- und Servicepartner des Konzerns in Nordamerika. Die Firma konnte insbesondere beim Rapid Prototyping starke Umsatzsteigerungen erzielen und ist heute eine feste Größe auf dem nordamerikanischen Markt.

---

#### **LPKF Properties LLC**

Diese im Vorjahr gegründete Gesellschaft hat den Zweck, Grund und Boden für LPKF Laser & Electronics Inc. zur Verfügung zu stellen. Die Gesellschaft ist Besitzerin des Firmengebäudes, das zur Zeit von LPKF Laser & Electronics Inc. genutzt wird.

---

#### **LPKF France S.A.R.L.**

Diese Firma hat sich zunächst insbesondere mit dem Vertrieb der Rapid Prototyping Systeme in Frankreich beschäftigt. Die Erwartungen konnten im Berichtsjahr voll erfüllt werden.

---

#### **LPKF Franklin Industries N.V.**

Die Gesellschaft hat ein negatives Ergebnis in Höhe von 154 TDM erzielt. Im Vorjahr wurden die restlichen Anteile der Gesellschaft gekauft, um eine schnellere Umstrukturierung zu ermöglichen und die Gesellschaft wieder in die Gewinnzone zu bringen. Die eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Kostenstruktur haben erste Erfolge erzielt und den Verlust im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduziert. Die volle Wirksamkeit der Maßnahmen werden sich erst im Jahre 2001 zeigen.

---

#### **LPKF Tianjin Co. Ltd.**

In China wurde die LPKF Tianjin Co. Ltd. als hundertprozentige Tochter gegründet. Neben dem Vertrieb wird dort auch die Musterproduktion von Prototypleiterplatten und Stencilschablonen eingerichtet. Auch Serviceleistungen wie Wartung und Reparatur werden von diesem Standort aus betrieben. Mit dieser Maßnahme soll der Zukunftsmarkt China schneller und umfangreicher bearbeitet werden, als es bisher mit Vertretern möglich war.

---

#### **Laserquipment AG**

Die LPKF Laser & Electronics AG hat sich mit 19,9 Prozent am Grundkapital der Laserquipment AG beteiligt. Das Unternehmen soll zwei- und dreidimensionale Systemlösungen für das Laserstrahl-Kunststoffschweißen entwickeln, produzieren und vertreiben. Die Zielmärkte sind die Automobil-,

Telekommunikations- und Consumer Electronics Industrie. Laserquipment ergänzt in hervorragender innovativer Weise das LPKF-Angebot, insbesondere im Bereich 3D-Bearbeitung.

#### **PhotonicNet GmbH**

LPKF hat sich mit 9,09 Prozent an der PhotonicNet GmbH beteiligt. Hier wird ein Kompetenzzentrum für optische Technologien gegründet. Es handelt sich um eine „Public Private Partnership“, an der viele namhafte Unternehmen beteiligt sind, mit dem Ziel optische Technologien in Deutschland beschleunigt voranzutreiben. Insbesondere ist die Entwicklung und Verbreitung von Lasertechnologien innerhalb eines großen industriellen und medizinischen Anwendungsgebietes gemeint. Die neue Gesellschaft will Wissen bereitstellen, Kooperationen vermitteln und für hochqualifizierten Nachwuchs werben und sorgen.

#### **Forschung und Entwicklung**

Im Bereich Forschung und Entwicklung wird kontinuierlich an kundenspezifischen Strukturierungsprojekten für die Feinleiterindustrie gearbeitet. Hier konnten im Berichtsjahr die endgültige Markteinführung der MicroLine-Systeme realisiert werden. Weiterhin ist die 3-D MID Technologie in einer wichtigen Phase. Die Entwicklung von laseraktivierbaren Thermoplastmaterialien zur additiven, also umweltfreundlichen, selektiven Metallisierung von beispielsweise Polypropylen machte entscheidende Schritte nach vorne in Bezug auf Technologie, Materialien und Herstellkosten. Eine 3-D Laseranlage (inkl. Steuerung) mit acht Achsen zur Strukturierung von dreidimensionalen Gehäusebauteilen wurde in 1999 entwickelt und produziert.

Es ist auch eine Pilotproduktionsanlage zur Herstellung von spritzgussfähigem Granulat im Labor für Mikrosystemtechnik der FH Lippe in Lemgo aufgebaut worden. Die momentane Produktionskapazität beträgt ca. 40 Tonnen/Jahr. Eine ausreichende Kapazität zur Bemusterung von ersten interessierten Kunden bis hin zur Kleinserienproduktion von 3-D MIDs ist realisiert und wird eingesetzt.

Im Rahmen eines BMBF-geförderten „MECHATRONIK“-Anschlussprojekts wird ab dem 01.01.2001 eine Übertragung der bereits erarbeiteten Forschung und Entwicklungs-Ergebnisse auf Hochtemperaturthermoplaste realisiert sowie eine Weiterentwicklung der 3-D MID Laseranlage zur Feinleiterstrukturierung. Die Förderungskonstellation insbesondere im Bereich der Materialentwicklung wurde dahingehend im Vorfeld geändert, dass entsprechende Entwicklungen auf LPKF Kosten geschehen werden, damit das entstehende Know-how dem Unternehmen ausschließlich für die kommerzielle Nutzung zur Verfügung steht. Zur Absicherung der Projektaufgaben aller Partner hat sich LPKF verpflichtet, dem Verbund Material in Form von Granulat über die gesamte Projektlaufzeit zur Verfügung zu stellen. Lasersysteme für die Herstellung von Polymer-Schablonen und zur Bearbeitung von Flexschaltungen werden die Entwicklung abrunden.

Im Berichtsjahr 2000 hat sich der Trend zur Miniaturisierung von elektronischen Schaltungen und somit der Einsatz hochpräziser Lasersysteme noch schneller entwickelt als von uns in den Vorjahren prognostiziert. Die Entwicklungsaufwendungen der vergangenen vier bis fünf Jahre werden sich in den Folgejahren umso mehr auszahlen.

Auf Grund der gegebenen Erfordernisse des Leiterplattenmarktes wird sowohl im Bereich der erarbeiteten FLEX- sowie der 3-D-Lasertechnologien von einer sehr hohen Marktakzeptanz ausgegangen. Jedoch ist auch hier u. U. mit zeitlichen Eintrittsverzögerungen zu rechnen.

Es geht nicht um die Frage, ob die entwickelte Technologie eingesetzt wird sondern ausschließlich um den Zeitpunkt der Umsetzung.

#### **Risikomanagementsystem**

Zunehmende Globalisierung der Märkte, eine fortschreitende Dynamisierung des Wettbewerbs sowie eine wachsende Komplexität der Technologien prägen das wirtschaftliche Umfeld unseres Unternehmens. Mit dem „Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich“ (KonTraG) sollen die rechtlichen Grundlagen für Risikomanagement- und Kontrollsysteme der Aktiengesellschaften verbessert werden. Auch die Einführung des Qualitätsmanagementsystems DIN EN ISO 9001:2000 wird in der Transparenz der Prozessketten im Unternehmen seinen Beitrag zur Risikominimierung leisten.

Ein effizientes und vorausschauendes Risikomanagement stellt für die LPKF Laser & Electronics AG eine wichtige und wertschaffende Aufgabe dar. Erstes Ziel ist nicht die Vermeidung aller Risiken, sondern deren Identifizierung und Bewertung und darauf aufbauend eine aktive Steuerung im Rahmen unserer globalen Risikostrategie.

Zur Erfassung und Steuerung von Risiken werden bestehende Instrumente ständig weiterentwickelt und neue aufgebaut.

---

### ***Geschäftsrisiken***

---

Die weltweiten Märkte der Elektronik bzw. Leiterplattenindustrie unterliegen Zyklen, die durch die Einführung neuer Technologien aber auch durch Wachstumsveränderungen geprägt sind. Der Markt des LPKF-Konzerns ist als Zulieferer der Elektronikindustrie im Bereich der Investitionsgüter angesiedelt und daher nicht unmittelbar den Zyklen der Halbleitertechnologie ausgesetzt. Die Investitionen in Technologien des LPKF-Konzerns sind mit Rationalisierungschancen und Wettbewerbsvorteilen verbunden und somit auch in Zeiten der Rezession gefragte Produkte. Auf dieser Basis können konjunkturelle Risiken minimiert aber nicht völlig ausgeschlossen werden.

---

### ***Abhängigkeit von Lieferanten***

---

Die Beschaffung von Komponenten und Dienstleistungen von Fremdlieferanten sind mit den grundsätzlichen Risiken von Lieferzeiten und Preisveränderungen behaftet. Dabei gibt es keine direkten Abhängigkeiten von einem oder mehreren Lieferanten. Dennoch sind ganz besonders Preisveränderungen Parameter, die die Geschäftstätigkeit beeinflussen können.

---

### ***Abhängigkeit von Kunden***

---

Die regionale Verteilung der Absatzmärkte ist ausgewogen, so dass hieraus keine besonderen Risiken entstehen. Es gibt keine Großkunden, auf die ein signifikanter Umsatzanteil entfällt. Auch hier gibt es eine sehr homogene und ausgewogene Struktur.

Die vielen neu gewonnenen Kunden werden vor einem Geschäftsabschluss auf ihre Bonität untersucht. Gegebenenfalls werden geeignete Maßnahmen eingeleitet, um auch hier eine Risikominimierung zu betreiben.

---

### ***Wechselkursschwankungen***

---

Die Wechselkurse fremder Währungen zu DM und EUR sind teilweise großen Schwankungen ausgesetzt. Für LPKF ist nur die Entwicklung gegenüber dem U.S. Dollar von Bedeutung. Die weitgehende Absicherung erfolgt über Kursicherungsinstrumente. Schwankungen der Währungskurse können das Ergebnis sowohl positiv als auch negativ beeinflussen.

---

### ***Forschung und Entwicklung***

---

Der Erfolg des LPKF-Konzerns hängt wesentlich davon ab, wie schnell die Neuentwicklungen von der Erstproduktion in das Seriengeschäft transferiert werden können. Die ersten Verkäufe nach der Präsentation der Neuentwicklung sind positive Indikatoren, dennoch müssen mit den potenziellen Kunden ganzheitliche Konzepte erarbeitet werden, um alle Vorteile der angebotenen Technologie auszuschöpfen.

Die Absicherung des „Know-how Vorsprungs“ erfolgt flankierend mit Patenten, dort wo es sinnvoll machbar ist. Bei allen F&E-Projekten, die zu serienreifen Produkten führen, ist die zeitliche Komponente grundsätzlich eine risikobehaftete Kenngröße. Dabei beinhaltet nicht nur der Zeitpunkt sondern auch die Erstmengendisposition des Serienproduktes Risiken. Auch in Zukunft ist ein erhebliches Investitionsvolumen für F&E-Projekte vorgesehen, wobei der relative Anteil am Umsatz abnehmen wird.

---

### ***Personalrisiken***

---

Qualifizierte Mitarbeiter sind sehr gesucht. LPKF hat durch intensive Hochschulkontakte keine Probleme, ausreichend Personal zu finden. Es gibt ein Mitarbeiterbeteiligungsmodell auf Basis von Wandelschuldverschreibungen, um so eine höhere Bindung an das Unternehmen sicherzustellen. Auch zukünftig wird diesem Thema mit neuen Konzepten Rechnung getragen, um das spezielle Know-how der Leistungsträger an das Unternehmen zu binden.

---

### ***Darstellung der Lage***

---

Insgesamt war der Geschäftsverlauf 2000 planmäßig und ist als positiv zu bezeichnen. Als wichtiger Geschäftsvorgang des Berichtsjahres ist der bestehende Kooperationsvertrag mit Atotech GmbH/Berlin zu nennen, der um eine Kooperation mit Lambda Physik AG/Göttingen erweitert worden ist. Dadurch ist die Versorgung mit adäquaten Laserquellen sichergestellt. Der erste MicroLine Laser wurde an Atotech ausgeliefert und dort in einen Gesamt-Leiterplattenherstellungsprozess integriert. Die Vermarktung dieses Prozesses findet durch Atotech statt.

Im dritten Quartal wurde ein Kooperationsvertrag mit der Enthone-OMI GmbH/Solingen realisiert, der als F&E-Kooperation für laserstrukturierte Feinstleitorschaltungen zu verstehen ist. Ergebnisse hierzu werden im Laufe von 2001 erwartet. Diese neuen Kooperationen werden zu Neuentwicklungen von Laserprozessen führen, die die Geschäftsentwicklung der folgenden Jahre stark beeinflussen können. Ergänzend hierzu ist die bestehende Kooperation mit der Mania AG/Weilrod zu nennen.

Hier wurden bisher zwei Flexrouter zur Bearbeitung von flexiblen Schaltungen als Demonstrations-systeme ausgeliefert. Weitere Ver-käufe gibt es im Berichtszeitraum nicht. Die neuen Unternehmens-beteiligungen sind einerseits gezielt zur Abrundung der Technologie-kompetenz und andererseits zur Verbesserung der weltweiten Markt-präsenz getätigt worden.

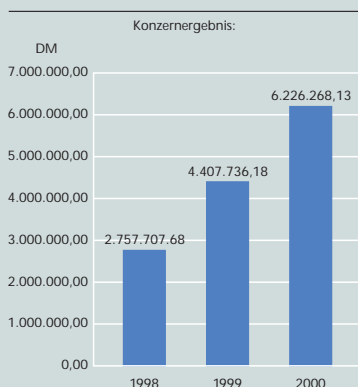
Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens ist solide. Die Kapital-flussrechnung zeigt die erhöhte In-vestitionstätigkeit. Hier sind einerseits die F&E Projekte zu sehen und ander-erseits die Kapazitätserweiterungen und Investitionen in Beteiligungen. Der signifikante Forderungsaufbau resultiert aus dem umsatzstarken Jahresende.

Die Vorräte wurden gezielt aufgebaut, um einen hohen Servicegrad gegen-über den Kunden sicherzustellen.

Die Erhöhung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus langfristigen Darlehen für die Neubauten in Garbsen und in Suhl.

Kapitalerhöhungen sind zur Zeit nicht beabsichtigt. Notwendigkeiten könnten sich durch Akquisitionen oder eine sehr stark wachsende Nachfrage im Bereich Lasersysteme ergeben.

Die Ertragslage des Unternehmens ist gut.



### Ausblick

Die Entwicklung des Unternehmens wird einerseits durch die Innovations-dynamik, die wegweisend für die nächsten Geschäftsjahre sein wird, und andererseits durch das Ab-schöpfen von Synergieeffekten be-stimmt sein. Auf dieser Basis ist die Projektion des Umsatzes und die weitere Steigerung der Profitabilität der Zukunft zu sehen. Die im Be-richtsjahr realisierten Kapazitätser-weiterungen in Garbsen und Suhl sind ausreichend, um die Wachstums-ziele zu erreichen. Auch die Erwei-terungen der Vertriebsaktivitäten in China sind eine wichtige Kompo-nente zur Erschließung eines Marktes, der zukünftig auch auf dem Sektor der Elektronik eine rasante Entwick-lung nehmen wird.

Weiterhin sind die Beteiligungen an der Laserequipment AG und PhotonicNet GmbH strategisch aus-gerichtete Investitionen, die zur Ab-rundung des weltweiten Auftritts in Bezug auf LPKF Produkte des LPKF-Konzerns aber auch die Kompetenz des Konzerns rund um die 2D- bzw. 3D-Technik, Leiterplatten- und Laser-technologie widerspiegelt.

Die zukünftige Entwicklung des Unter-nemens wird eindeutig geprägt durch eine hochinnovative Entwick-lungstätigkeit und die Umsetzung der Unternehmensstrategie in welt-weite Akzeptanz. Dies betrifft sowohl Technologien, die in der Zukunft liegen, aber auch Systeme und Pro-zesse, die an der Schwelle zur Markt-einführung stehen. Im gleichen Atemzug mit den genannten tech-nologischen Risiken und Unwägbar-keiten der Marktakzeptanz sind die großen Chancen zu nennen, die sich im Wachstumsmarkt Elektronik dem Unternehmen bieten. Diese Konstellation kann im Produktmix kurzfristig zu Änderungen bei den Planzahlen führen. Sie wird den Trend von Miniaturisierung und immer kürzeren Lebenszyklen bei den Produkten nicht aufhalten können.

### Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

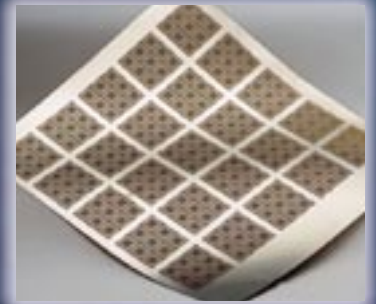
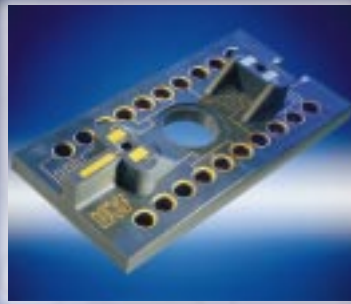
Die LPKF Laser & Electronics AG hat im Januar 2001 fünftausend Stück eigene Aktien erworben. Weitere Vor-gänge, die das im vorliegenden Konzern-Abschluss dargestellte Bild der Lage des Konzerns beeinflussen könnten, sind nach dem Ende des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

LPKF Laser & Electronics AG · Garbsen, 16. Februar 2001

*Bernd Hildebrandt* Bernd Hildebrandt     *B. Hackmann* Bernd Hackmann     *J. Kickelhain* Dr. Jörg Kickelhain

### Organe der Gesellschaft





Schlüsseltechnologien für morgen ...





Der Erfolg steckt im Detail ...



## *Der Elektronikmarkt – Chance und Herausforderung*

Das Jahr 2000 war für die Elektronikindustrie das erfolgreichste ihrer bisherigen Geschichte. Erstmals wurde auf dem weltweit größten Markt das Gesamtvolumen von US \$ 1.000 Milliarden überschritten. Diese Zahl markiert den vorläufigen Höhepunkt einer bereits mehr als 20jährigen Erfolgsgeschichte.

Seit über zwei Jahrzehnten liegt das durchschnittliche Wachstum für elektronische Anlagen und Geräte bei mehr als elf Prozent. Setzt sich diese Tendenz fort, könnte der Produktionswert im Jahr 2005 die Rekordmarke von US \$ 2.000 Milliarden erreichen (Quelle: VDMA-Marktinformationen Productronic/Konjunkturberichte 09/ 2000). Verbunden mit dieser Entwicklung ist aber auch eine Verschärfung der Produktionsbedingungen. Dabei sind es vor allem zwei Trends, für die sich Hersteller und Entwickler wappnen müssen: fortschreitende Miniaturisierung und ein immens gestiegenes Entwicklungstempo.

Infolge der immer stärkeren Konkurrenzsituation haben sich die Lebenszyklen elektronischer Produkte in den vergangenen Jahren drastisch verkürzt. Entwicklungszeiten von mehreren Monaten, wie sie noch vor kurzem die Regel waren, sind heute nicht mehr akzeptabel. Time-to-Market bzw. Time-to-Profit werden für Entwickler wie Produzenten zu Faktoren, die über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Zwangsläufig sinken dabei die Auflagenhöhen für einzelne Produkte. Darum bedarf es einer Technologie, die in der Lage ist, einerseits die Prototypenentwicklung zu beschleunigen, andererseits auch

kleine und mittlere Serien zu wirtschaftlichen Bedingungen zu fertigen. Verschärft wird der Druck durch den Trend zu immer kleineren und leichteren Geräten mit höherer Leistungsfähigkeit. Weil immer mehr Funktionen auf immer weniger Raum integriert werden müssen, stoßen wir beispielsweise bei herkömmlichen Methoden innerhalb der Leiterplattenherstellung schon bald auf Grenzen. Ein unvermeidlicher Technologiewechsel zeichnet sich ab.

## *Mit Know-how neue Märkte gestalten*

Als Entwickler und Vermarkter von Systemen und Prozessen für die Elektronikproduktion, insbesondere der Schaltungsherstellung, hat LPKF Laser & Electronics diese Tendenzen bereits vor Jahren erkannt. Das Unternehmen sucht – oft in engem Kontakt mit seinen Kunden – nach den optimalen technischen Lösungen, um den Herausforderungen eines stark wachsenden Marktes zu begegnen. Einer der Grundsätze der Firmenphilosophie ist dabei, nicht auf „fahrende Züge“ aufzuspringen, sondern stets nach neuen und innovativen Prozessen zu suchen. Das Ziel dieser Unternehmenspolitik heißt: neue Märkte finden, die Marktführerschaft übernehmen, ausbauen und halten.

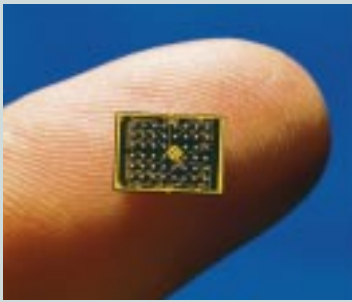
Stets war es eins der Erfolgsrezepte von LPKF, alle Schlüsselkomponenten wenn möglich selbst zu entwickeln; von der Software über die Mechanik bis hin zur Steuerungstechnik und hauseigenen Lasertechnologie. Dadurch wird eine perfekte Abstimmung gewährleistet, die einen besonders einfachen und schnellen Service ermöglicht. Unsere Kunden, zu denen neben kleinen und mittelständischen

Produzenten eine Reihe multinationaler Elektronikkonzerne zählen, wissen diese Vorteile zu schätzen. Die Marktführerschaft, die LPKF bei den meisten seiner Produkte erreicht hat, versetzt das Unternehmen zudem in die Lage, selbst Preismaßstäbe setzen zu können und so eine optimale Wertschöpfung zu erzielen.

## *Lasertechnik revolutioniert die Elektronikproduktion*

Experten sind sich einig: Lasertechnologien für zukünftige Produktionsprozesse der Elektronikindustrie gewinnen immer mehr an Bedeutung. Nach Einschätzung der Branche wird der Weltmarkt für Lasermaterialbearbeitungssysteme bis zum Jahr 2004 auf knapp 13 Milliarden DM wachsen und sich damit gegenüber dem derzeitigen Stand mehr als verdoppeln (Quelle: Optech Consulting PK 04/00). Eine Schlüsselrolle übernehmen Laseranlagen insbesondere bei der Miniaturisierung elektronischer Baugruppen. Besondere Bedeutung erhält dabei die Feinststrukturierung von Leiterplatten mit hohen Integrationsdichten, sogenannte HDIs (High Density Interconnect), wie sie heute bei Mobiltelefonen, Camcordern, Organizern oder digitalen Kameras zum Einsatz kommen.

Auch die Umsetzung von innovativen Konzepten innerhalb der Aufbau- und Verbindungstechnik (Packaging) wird ohne den Einsatz der Lasertechnik nicht oder nur unvollkommen möglich sein.



CSP auf Finger

---

### **Schlüsseltechnologie für die nächste Chip-Generation**

---

Eins der Haupteinsatzgebiete für Lasertechnologie bildet bei LPKF die Familie der StencilLaser. Die Qualität von lasergeschnittenen Stencils (Schablonen) zum Lotpastendruck ist ein Schlüssel, um die Ausschussrate bzgl. der Produktion von elektronischen Baugruppen innerhalb der Massenfertigung niedrig zu halten. Sie gewährleisten ein sparsames und präzises Aufbringen der Lotpaste auf den Schaltungsträger. Bereits mit der Einführung lasergeschnittener Metallschablonen konnte LPKF eine zuverlässige und umweltfreundliche Alternative zur bis dahin üblichen Ätztechnik etablieren. Mit der Einführung des LPKF Polymer StencilLasers ist es nun erstmals möglich, Stencils aus hauchdünnen Polyimidfolien herzustellen. Neben einer nochmaligen Verringerung der Ausschussrate ermöglicht dieses Material die Realisierung weitaus feinerer Strukturen im Lotpastendruck (bis zu 50 µm). Mit dieser zukunftsweisenden Technologie, die z. B. für die Anbindung der nächsten Chip-Generation an die Leiterplatte unverzichtbar ist, festigt LPKF seine Führungsposition auf dem Wachstumsmarkt der StencilLaser.

---

### **Die Zukunft heißt MicroLine**

---

Bereits jetzt steht fest, dass herkömmliche Strukturierungsprozesse bei der Produktion von HDI-Boards bald an ihre Grenzen stoßen. Schon im Jahr 2003 werden in diesem Bereich Strukturbreiten von ca. 30 µm, im Jahr 2006 sogar 20 µm, Standard sein (Quelle: The Board Authority 10/99). Mit dem MicroLine-Laser hat LPKF ein Werkzeug geschaffen, das bereits jetzt diese Standards erfüllt. Untrennbar verbunden mit dem Technologiewechsel auf dem Leiterplattensektor ist der Begriff CSP (Chip Size Packaging). Dahinter steht eine neuartige Packagingvariante für Halbleiter, die es ermöglicht, die Bauteilgröße der zukünftigen Elektronikbauteilgeneration auf ein Minimum zu reduzieren.

Der Anteil der Chips in CSP beläuft sich derzeit auf US \$ 1,6 Billionen. Bis zum Jahre 2005 wird erwartet, dass dieser Markt einen Anteil von mehr als US \$ 8,6 Billionen erreicht (Quelle: TechSearch International). Die Realisierung der dafür notwendigen extrem feinen Leiterbahnen und Isolationskanäle ist derzeit nur mit Hilfe der MicroLine-Technologie im Zusammenhang mit umweltfreundlichen Metallisierungstechniken erreichbar.

In Kooperation mit der Atotech Deutschland GmbH ist es LPKF gelungen, die MicroLine-Technologie auch in die herkömmliche Ätztechnik zu integrieren und so ein neues Verfahren für die Massenproduktion von hochauflösenden Leiterplatten zu schaffen. Mit dieser Technologie ist es möglich, im Zusammenhang mit chemischem Ätzen und dem Einsatz der Lasertechnologien Feinststrukturen von bis zu 30 µm zu erreichen.

Bedingt durch diese Kombination konnte der Ätzprozess effektiver gestaltet werden. Das Ätzverfahren wird heute zu ca. 98 Prozent bei den Leiterplattenherstellern eingesetzt. Um diesen auch den Einstieg in die HDI-Technologie zu ermöglichen, bietet die MicroLine-Technologie einen wirtschaftlichen Einstieg weitestgehend ohne kostspielige Umrüstungen.

---

### **3D-Schaltungen – vom Gehäuse zum Funktionsträger**

---

Einen Quantensprung auf dem Weg zur Miniaturisierung elektronischer Baugruppen bedeutet die Integration von mechanischen und elektronischen Komponenten. Bei dieser sogenannten 3D-MID-Technologie wird das Gehäuse als eine Art dreidimensionale Leiterplatte selbst zum Schaltungsträger. Rationellere Fertigung, neue Freiräume bei der Bauteilgestaltung und kürzere Prozessketten sind die wichtigsten Vorteile einer Technologie, die in der Leiterplattenindustrie mehr und mehr auf Interesse stößt. LPKF ist in der Lage, Kunststoffmaterialien (Granulat) so zu modifizieren, dass sie mittels eines Laserstrahls aktiviert werden können. Auf diesen so aktivierten Bereichen können dann in chemischen Bädern Leiterbahnstrukturen abgeschieden werden. Das Verfahren ist inzwischen zur Marktreife geführt und wird derzeit auf weitere, für den Elektronikmarkt interessante Materialien adaptiert. LPKF hat damit abermals bedeutenden Anteil an der Entwicklung eines Marktes, der ein enormes Wachstumspotential verspricht.



LPKF ScanCheck (AOI-System)

### Prozesskontrolle auf Spitzenniveau

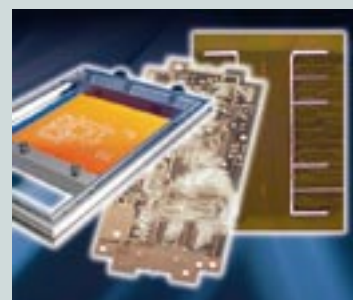
Die Qualitätssicherung gewinnt nicht zuletzt im Rahmen der ISO 9000-Zertifizierung bei Industrieunternehmen zunehmend an Bedeutung. Gerade Hersteller und Anwender von Stencils können und wollen nicht länger auf eine zuverlässige Überprüfung ihrer Produkte verzichten. LPKF bietet deshalb die Möglichkeit einer optimalen Prozesskontrolle in der Stencilfertigung. Das Prüfsystem LPKF ScanCheck erkennt schnell und zuverlässig Fehler bei Lotpastenschablonen, von Produktionsmängeln über Verarbeitungsfehler bis hin zum „damage during use“. Mit dem erweiterten Inspektions- und Mess-System LPKF QuickMeasure ist zusätzlich die hochpräzise Vermessung des Stencils möglich. Diese Vorrichtung erlaubt z. B. stichprobenartige Überprüfungen und Vermessungen von besonders kritischen Bereichen. Die ausgedruckten Berichte erfüllen die Funktion eines gültigen Prüfzertifikats und sind so gleichzeitig ein effektives Marketinginstrument. Mit der Einführung der beiden Systeme hat LPKF neue Standards in puncto Qualitätskontrolle für Lotpastenschablonen gesetzt.



LPKF Protomaten (Fräsbohrplotter)

### Steigerung beim In-house Prototyping

Das rasante Tempo auf dem Elektronikmarkt stellt auch die Entwicklungslabors vor eine neue Situation. Im vergangenen Jahr hat sich gezeigt, wie knapp inzwischen Zeitbudgets bemessen werden, die für die Entwicklung neuer Produkte zur Verfügung stehen. Zunehmend muss die gesamte Herstellung von Leiterplattenprototypen vor Ort und unabhängig von externen Dienstleistern erfolgen. Mehr denn je sind deshalb Entwickler auf eine Technologie angewiesen, die alle Voraussetzungen für die Produktion eines funktionsfähigen Prototypen im eigenen Labor erfüllt. Als einziges Unternehmen weltweit liefert LPKF dafür die vollständige Problemlösung und das nötige Prozess-Know-how. Dabei belegen die Absatzsteigerungen, vor allem in den USA, sowie die gestiegene Nachfrage zu höherwertiger Ausrüstung, dass In-house Prototyping inzwischen auf dem Weg ist, zu einem industrieweiten Standard zu werden.



Anwendungsbeispiele im Rapid Prototyping

Neue Maßstäbe für die Prototypenherstellung setzt LPKF durch die erstmalige Kombination von herkömmlicher Fräsbohr- und Lasertechnik. Das Know-how der beiden wichtigsten Unternehmensbereiche verbindet sich hier zu einer zukunftsweisenden Technologie, die es auch den Labors ermöglicht, in den Bereich der Feinstleiterstrukturierung vorzustoßen. Damit unterstützt die Innovationsarbeit von LPKF den Entwicklungssektor dabei, sich ebenfalls für den derzeit wichtigsten Trend, die Miniaturisierung von Baugruppen, zu rüsten.



## Bohren und Strukturieren ...



Ernst-Christoph Gräter, Geschäftsführer der Korsten & Goossens GmbH, an der ersten Installation des MicroLine Drill.

### *Eine Weltneuheit in sechs Monaten*

Ein Paradebeispiel in Sachen kundennaher Entwicklungsarbeit bot im vergangenen Jahr die Einführung einer in ihrer Technik einzigartigen Laserbohrmaschine durch LPKF. Anlass für diesen Schritt war ein spürbarer Druck des Marktes, der heute bereits Leiterplatten-Produzenten zwingt, ihre Produktionstechnik zur Herstellung hochintegrierter Schaltungen (HDIs) auszustatten. Für viele ist deshalb der Einstieg in die hierfür unverzichtbare Laserbohrtechnologie und die Mikrostrukturierung unvermeidlich. Die hohen Investitionskosten waren aber bisher für mittelständische PCB-Hersteller eine unüberwindbare Hemmschwelle. Mit dem LPKF MicroLine Drill erhalten jetzt auch diese Leiterplattenhersteller die Möglichkeit, HDIs zu produzieren. Es wurde hier in einem System das Strukturieren von Feinstleiter-schaltungen mit dem Bohren sogenannter Microvias vereint (Mikrobohrungen, die verschiedene Ebenen von Mehrlagenschaltungen verbinden). Das System basiert auf einer Technik, die bei LPKF bereits in Ansätzen vorlag. So konnte die Entwicklungszeit auf ein fast schon rekordverdächtiges Minimum verkürzt und der Preis günstig gehalten werden.

## Agenda:

### April 2000

Mehrere Leiterplattenhersteller bekunden bei LPKF Interesse an einem kombinierten Lasersystem, das die Möglichkeiten des Microviabohrens und der Feinstrukturierung miteinander verbindet. Gewünscht wird ein Gerät, das in der Lage ist, sowohl Microvias für mehrlagige Schaltungen zu bohren, als auch Feinstrukturen zwischen 30 und 50 µm zu erzeugen. Diese werden im Bereich der HDI-Leiterplatten benötigt. Wirtschaftlich interessant ist eine solche Lösung vor allem für kleine und mittelständische Produzenten. Man erkennt bei LPKF, dass sich durch die Verbindung beider Technologien die Chance bietet, dieser Kundengruppe ein kombiniertes Gerät zu einem erschwinglichen Preis anzubieten.



Die Korsten & Goossens GmbH mit Sitz in Haan bei Düsseldorf, stellt seit mehr als 30 Jahren Leiterplatten her.

### Mai 2000

Eine Markt- und Konkurrenzanalyse wird durchgeführt mit dem Ergebnis, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Anwendung Microviabohrens extreme Zuwachsraten aufweist. In den nächsten Jahren werden allein auf diesem Sektor 4000 (Quelle: CircuiTree 12/00) Neuinstallationen erwartet. Die Absatzchancen für ein Gerät, das zusätzlich die technischen Möglichkeiten der Mikrostrukturierung besitzt, können deshalb als überdurchschnittlich hoch eingeschätzt werden.

### Juni 2000

In Zusammenarbeit mit unserem Partner LPKF d.o.o. in Slowenien werden erste Machbarkeitsstudien durchgeführt. Grundlage ist die Verwendung eines bereits vorhandenen hauseigenen Lasersystems basierend auf Erfahrungen aus dem StencilLaser Bereich. Versuche, in denen marktübliche Leiterplattenmaterialien getestet werden, führen zu vielversprechenden Ergebnissen. Nachdem sich die prinzipielle Tauglichkeit in mehreren Testreihen erwiesen hat, wird das System zielgerichtet weiterentwickelt und optimiert.

### August 2000

Die ersten Bemusterungen von Bohrungen und Strukturen an potentielle Kunden erfolgen. Die Kunden erhalten die Möglichkeit, die Muster im eigenen Betrieb zu beurteilen und weiterzuverarbeiten, um beispielsweise die Kompatibilität mit den verwendeten Ätzmedien und Standardchemikalien zu überprüfen. Dabei zeigt sich durchgängig, dass das System voll in die jeweilige Haus-technologie integriert und ohne Verzug eingesetzt werden kann. Von nun an erfolgt die Weiterentwicklung in enger Abstimmung mit zukünftigen Anwendern.

### September/Oktober 2000

Nach nur dreimonatiger Entwicklungszeit ist der erste Prototyp fertig gestellt. Es erfolgen weitere Kundenbemusterungen mit nochmals optimierter Bohr- und Strukturqualität. Immer stärker werden jetzt Verbesserungsvorschläge bezüglich der Ergebnismenge und gesonderte Kundenwünsche bei der Weiterentwicklung der Anlage berücksichtigt. Der Durchsatz des Gerätes wird deutlich erhöht. Eine Konzeption der Bedienungssoftware wird erstellt.



LPKF MicroLine Drill

### November 2000

Auf der electronica2000 in München, der weltweit wichtigsten Elektronikmesse, wird der MicroLine Drill der Öffentlichkeit präsentiert. Das Interesse an dem neuesten LPKF-Produkt, das erstmals die technischen Möglichkeiten von Microviabohren und Feinstrukturieren miteinander verbindet, ist überwältigend. Dabei wird deutlich, wie stark inzwischen der Druck auf die Hersteller ist, ihre Produktionsketten mit HDI-tauglicher Technologie aufzurüsten. Es zeigt sich, dass der LPKF MicroLine Drill exakt dieses Bedürfnis bedient. Noch während der Messe wird das erste System verkauft.

### Dezember 2000/Januar 2001

Es kommt zum Verkauf eines weiteren Systems an einen Leiterplattenhersteller. Die Anlagen werden installiert. Die Implementierung der Software wird von LPKF vorgenommen. In Kooperation mit den Kunden finden weitere Systemoptimierungen statt.

### Februar/März 2001

LPKF startet eine weltweite Marketingkampagne für den MicroLine Drill.



LPKF Laser & Electronics



Wachstumsmotor Elektronik ...

Suhl, Thüringen

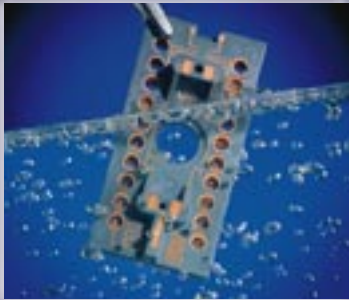
LPKF Laser Components GmbH  
Garbsen, 25.000 EUR · 80%

Laserquipment AG,  
50.000 EUR · 19%

Die Hauptversammlung

Der Aufsichtsrat

Klaus Süßer - Vorsitzender  
Dr. Heino Büsching - stellvertretender Vorsitzender  
Udo B. Hartmann



<b>Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung</b>	27
<b>Eigenkapitalveränderungsrechnung</b>	27
<b>Konzernbilanz</b>	
<b>Aktiva</b>	28
<b>Passiva</b>	29
<b>Konzernkapitalflussrechnung</b>	30
<b>Konzernanhang</b>	
Grundsätze der Aufstellung des Konzernabschlusses	31
Konsolidierungskreis	31
Finanzinstrumente	32
Währungsumrechnung	32
<b>Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung</b>	
1. Umsatzerlöse	33
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	33
3. Sonstige betriebliche Erträge	34
4. Materialaufwand	34
5. Personalaufwand und Mitarbeiter	34
6. Abschreibungen	34
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	35
8. Finanzergebnis	35
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35
<b>Konzernbilanz</b>	
<b>Aktiva</b>	
10. Anlagevermögen	36
11. Vorräte	38
12. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38
13. Sonstige Vermögensgegenstände	38
14. Liquide Mittel	38
15. Rechnungsabgrenzungsposten	38
16. Steuerabgrenzungsbetrag	38
<b>Passiva</b>	
17. Gezeichnetes Kapital	39
18. Kapitalrücklage	39
19. Genehmigtes Kapital/bedingtes Kapital	39
20. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	39
21. Rückstellungen für Pensionen	40
22. Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen	40
23. Verbindlichkeiten	41
24. Anleihe	41
25. Steuerabgrenzungsbetrag	41
<b>Sonstige Angaben</b>	
26. Kapitalflussrechnung	41
27. Gewinn pro Aktie	42
28. Dividende je Aktie	42
29. Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen	42
30. Sonstige Angaben	42
31. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag	43
<b>Bestätigungsvermerk</b>	43
<b>Jahresabschluss der LPKF Laser &amp; Electronics AG</b>	
<b>Bilanz der LPKF Laser &amp; Electronics AG</b>	
<b>Aktiva</b>	44
<b>Passiva</b>	45
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	46

# Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

## Gewinn- und Verlustrechnung

	Anhang	01.01.-31.12.2000 TDM	01.01.-31.12.1999 TDM
Umsatzerlöse	(1)	54.761	38.619
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		2.001	3.631
andere aktivierte Eigenleistungen	(2)	2.832	2.950
sonstige betriebliche Erträge	(3)	2.728	2.017
		<u>62.322</u>	<u>47.217</u>
Materialaufwand	(4)	17.172	12.099
Personalaufwand	(5)	15.590	11.388
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(6)	4.202	3.016
sonstige betriebliche Aufwendungen	(7)	13.061	11.390
<b>Betriebsergebnis</b>		<u>12.297</u>	<u>9.324</u>
Finanzergebnis	(8)	-205	-275
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>12.092</u>	<u>9.049</u>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	(9)	5.508	4.429
Konzernjahresüberschuss		<u>6.584</u>	<u>4.620</u>
Ausgleichsposten für andere Gesellschafter		-358	-212
<b>Konzernergebnis</b>		<u>6.226</u>	<u>4.408</u>
Ergebnis pro Aktie - unverwässert - DM	(27)	0,59	0,42
Ergebnis pro Aktie - verwässert - DM	(27)	0,57	0,40

Konzernbilanz  
Kapitalflussrechnung  
Konzernanhang  
Jahresabschluss 2000

Aufstellung über die Veränderungen des Eigenkapitals für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2000 (Vorjahr in Klammern)

	Stand 1.1.2000	Erfolgs- neutrale Anpassung der EB-Werte	Kapital- erhöhung aus Ge- sellschafts- mitteln	Einzah- lungen durch Kapital- erhöhung	Ausschüt- tungen an Anteils- eigner	Konzern- ergebnis	Differenzen aus der Währungs- Umrechnung	Stand 31.12.2000
	TDM	TDM	TDM	TDM	TDM	TDM	TDM	TDM
Gezeichnetes Kapital	10.500	-	10.036	-	-	-	-	20.536
	(10.500)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(10.500)
Kapitalrücklagen	17.121	-	-10.036	-	-	-	-	7.085
	(17.100)	(-)	(-)	(21)	(-)	(-)	(-)	(17.121)
Gewinnrücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Gesetzliche Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Rücklagen für eigene Anteile	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Satzungsmäßige Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Andere Gewinnrücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Bilanzgewinn	8.660	-180	-	-	-1.050	6.226	-	13.656
	(4.252)	(-)	(-)	(-)	(-)	(4.408)	(-)	(8.660)
Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung	334	-	-	-	-	-	195	529
	(-159)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(493)	(334)
Summe	36.615	-180	-	-	-1.050	6.226	195	41.806
	(31.693)	(-)	(-)	(21)	(-)	(4.408)	(493)	(36.615)

Die erfolgsneutrale Anpassung der Eröffnungsbilanzwerte betrifft die Bewertung der latenten Steuern (vgl. Tz 9). Die Kapitalrücklage beinhaltet den Eigenkapitalanteil der Wandelanleihe in Höhe von TDM 21.

# Konzernbilanz: Aktiva

		31.12.2000	31.12.1999
<i>Aktiva</i>	Anhang	TDM	TDM
<b>Anlagevermögen</b>			
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	(10)		
Software		131	91
Geschäfts- oder Firmenwert		1.089	1.397
Entwicklungsleistungen		5.034	3.146
Nutzungsrechte		941	1.115
		<u>7.195</u>	<u>5.749</u>
<i>Sachanlagen</i>	(10)		
Grundstücke, grundstücksgl. Rechte und Bauten		11.842	5.431
technische Anlagen und Maschinen		1.855	2.605
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.681	3.191
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0	1.804
		<u>17.378</u>	<u>13.031</u>
<i>Finanzanlagen</i>	(10)		
Anteile an verbundenen Unternehmen		36	36
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		22	0
Beteiligungen		5	0
Sonstige Ausleihungen		6	7
		<u>69</u>	<u>43</u>
<b>Total Anlagevermögen</b>		<b>24.642</b>	<b>18.823</b>
<b>Umlaufvermögen</b>			
Vorräte	(11)		
(System-) Teile		2.170	2.151
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		340	820
fertige Erzeugnisse und Waren		11.919	9.831
geleistete Anzahlungen		315	269
		<u>14.744</u>	<u>13.071</u>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(12)	14.493	6.076
Sonstige Vermögensgegenstände	(13)	1.020	1.665
		<u>15.513</u>	<u>7.741</u>
Wertpapiere	(14)	120	117
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	(14)	7.349	12.875
<b>Total Umlaufvermögen</b>		<b>37.726</b>	<b>33.804</b>
Rechnungsabgrenzungsposten	(15)	233	67
Steuerabgrenzungsbetrag	(16)	823	375
<b>Total Aktiva</b>		<b>63.424</b>	<b>53.069</b>

# Konzernbilanz: Passiva

		31.12.2000	31.12.1999
<i>Passiva</i>	Anhang	TDM	TDM
<b>Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	(17)	20.536	10.500
Kapitalrücklage	(18)	7.085	17.121
Gewinnvortrag		7.430	4.252
Konzernergebnis		6.226	4.408
Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung		529	334
<b>Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter</b>	(20)	2.553	2.163
		<u>44.359</u>	<u>38.778</u>
<b>Rückstellungen</b>			
Rückstellungen für Pensionen	(21)	374	362
Steuerrückstellungen	(22)	2.717	1.589
Sonstige Rückstellungen	(22)	1.812	1.330
		<u>4.903</u>	<u>3.281</u>
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Anleihe	(24)	485	482
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	(23)	6.226	3.310
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		35	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.538	2.094
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		5	0
Verbindlichkeiten gegen assoziierte Unternehmen		22	0
Sonstige Verbindlichkeiten		1.761	3.844
		<u>11.072</u>	<u>9.730</u>
Rechnungsabgrenzungsposten		127	62
Abgrenzungsposten Zuwendungen	(3)	1.036	274
Steuerabgrenzungsbetrag	(25)	1.927	944
<b>Total Passiva</b>		<b>63.424</b>	<b>53.069</b>

# Konzernkapitalflussrechnung

		31.12.2000	31.12.1999
	Anhang	TDM	TDM
<b>Laufende Geschäftstätigkeit</b>			
Jahresüberschuss		6.584	4.620
Abschreibungen auf das Anlagevermögen		4.202	3.016
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		142	-3
Veränderungen der Vorräte, Forderungen und sonstige Aktiva		-10.062	-2.669
Veränderungen der Verbindlichkeiten sowie sonstige Passiva		630	576
Veränderungen der Rückstellungen		1.545	1.802
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(26)	3.041	7.342
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte		-10.273	-8.950
Investitionen in Tochterunternehmen		0	1.545
Einzahlungen aus Anlageabgängen		45	40
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit		-10.228	-7.365
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Zahlung Dividende		-1.050	0
Zahlung Dividende an Minderheitsgesellschafter		-94	0
Eigenkapitalanteil Wandelschuldverschreibung		0	21
Veränderung langfristige Bankdarlehen		3.669	-4.701
Mittelab-/zufluss aus der Finanzierungstätigkeit		2.525	-4.680
<b>Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>			
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestandes		-111	37
Veränderungen des Finanzmittelbestandes		-4.662	-4.703
Finanzmittelbestand am 01.01.2000		12.122	16.788
Finanzmittelbestand am 31.12.2000		7.349	12.122
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes</b>			
Liquide Mittel		7.349	12.875
Kontokorrentverbindlichkeiten		0	-753
Finanzmittelbestand		7.349	12.122

## Grundsätze der Aufstellung des Konzernabschlusses

Der Konzernabschluss auf den 31. Dezember 2000 der LPKF Laser & Electronics AG, Garbsen, wurde nach einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen aufgestellt. Die Anpassung der latenten Steuern gemäß des überarbeiteten IAS 12 wurde für das Jahr 2000 vorgezogen. IAS 39 wurde nicht vorzeitig angewendet. Ansonsten fanden die am Bilanzstichtag geltenden Standards des International Accounting Standards Committee (IASC) Anwendung.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Der Konzernabschluss ist in Deutscher Mark aufgestellt worden.

## Konsolidierungskreis

Neben der Konzernmutter LPKF Laser & Electronics AG, Garbsen, sind folgende Tochterunternehmen in den Konzernabschluss einbezogen worden:

Name	Sitz	Beteiligungsquote %	Erwerb
<b>Vollkonsolidierung</b>			
ELASER Gesellschaft für Elektronik, Laser und Automation GmbH	Suhl/Thüringen	100,0	1989
LPKF d.o.o.	Kranj/Slowenien	75,0	1995
LPKF Franklin Industries N.V.	Mechelen/Belgien	100,0	1999
LPKF Laser & Electronics Inc.	Wilsonville/USA	60,0	1999
A-Laser Inc.	Beaverton/USA	100,0	1999
LPKF Motion & Control GmbH	Suhl/Thüringen	50,9	1999
LPKF Properties LLC	Wilsonville/USA	60,0	1999
LPKF France S.A.R.L.	Lisses/Frankreich	94,0	1999
LPKF Laser Components GmbH	Garbsen/Niedersachsen	80,0	1999
LPKF (Tianjin) Co. Ltd.	Tianjin/China	100,0	2000

LPKF (Tianjin) Co. Ltd. wurde für TDM 1.125 erworben. Die Einlage wird sowohl bar als auch durch Sacheinlage erbracht. TDM 117 wurden bisher bar eingezahlt. Die Sacheinlage steht noch aus.

Weitere Konzernbeteiligungen, die als Minderheitsbeteiligungen nicht voll konsolidiert werden, sind:

Name	Sitz	Beteiligungsquote %	Erwerb
Laserequipment AG	Erlangen/Bayern	19,99	2000
PhotonicNet GmbH	Hannover/Niedersachsen	9,09	2000

Die Laserequipment AG befand sich zum Bilanzstichtag in Gründung. Die Einzahlung in Höhe von TDM 22 für eine Beteiligung von 19,99 % wurde noch nicht im Geschäftsjahr 2000 geleistet.

Der Konsolidierungskreis hat sich im Jahr 2000 wie folgt geändert: Zum Jahresende erfolgten zwei Neugründungen. LPKF (Tianjin) Co. Ltd. in China wird vollkonsolidiert. Da der Konzern die Möglichkeit hat, an den finanz- und geschäftspolitischen Entscheidungsprozessen mitzuwirken (maßgeblicher Einfluss), wird die Laserequipment AG nach der Equity-Methode konsolidiert.

## Konsolidierungsgrundsätze

Grundlage für den Konzernabschluss sind die nach einheitlichen Regeln zum 31. Dezember 2000 aufgestellten Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften.

Bei der Kapitalkonsolidierung werden die Anschaffungswerte der Beteiligungen mit dem auf sie entfallenden Eigenkapitalanteil zum Zeitpunkt des Erwerbs verrechnet.

Ein sich ergebender Unterschiedsbetrag wird den Vermögenswerten und Schulden insoweit zugerechnet, als deren Zeitwert vom Buchwert abweicht. Ein verbleibender aktiver Unterschiedsbetrag wird als Geschäfts- oder Firmenwert ausgewiesen und über 5 Jahre abgeschrieben.

Zwischenergebnisse, Aufwendungen und Erträge sowie Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den vollkonsolidierten Gesellschaften wurden eliminiert. Zwischenergebnisse mit assoziierten Unternehmen werden anteilig eliminiert.

Es werden nach der „liability method“ auf alle temporären Differenzen zwischen den steuerlichen Werten und den Buchwerten der Vermögenswerte und der Schulden latente Steuern erfasst. Die Ertragssteuern sind aufgrund der gültigen Gesetze und Verordnungen berechnet.

## Finanzinstrumente

Die bilanzierten Finanzinstrumente enthalten liquide Mittel, Beteiligungen, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und übrige Fremdfinanzierungen und Finanzanlagen. Die einzelnen Bilanzierungsmethoden werden unter dem jeweiligen Posten erläutert.

Auf die finanziellen Schulden wird unter Tz 23 bezuggenommen. Derivate waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden. Unterjährig wurden jedoch Devisentermingeschäfte zur Absicherung von US-Dollar-Geschäften vorgenommen.

## Sonstige Ansatz- und Bewertungsmethoden

Die Vermögenswerte werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Entwicklungsprojekte werden, sofern die Kriterien nach IAS 38 erfüllt sind, aktiviert und zu Material- und Personalkosten bewertet.

## Währungsumrechnung

Die Umrechnung der Jahresabschlüsse der ausländischen Gesellschaften erfolgt nach der Methode der funktionalen Währung. Bei dieser Umrechnung in Deutsche Mark wurden die Vermögenswerte und Schulden mit dem Mittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. Die Aufwendungen und Erträge wurden mit dem Jahresdurchschnittskurs umgerechnet. Die Umrechnungsdifferenzen wurden ergebnisneutral unter dem Eigenkapital als Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung ausgewiesen. Den Berechnungen der Konzernzahlen lagen die Wechselkurse der folgenden Tabelle zugrunde.

In DM	Stichtagkurs		Durchschnittskurs	
	31.12.2000	31.12.1999	31.12.2000	31.12.1999
100 Französische Franc	29,81640	29,81640	29,81640	29,81640
100 Belgische Franc	4,84838	4,84838	4,84838	4,84838
10.000 Slowenische Tolar	91,6508	98,5702	94,6930	100,6223
1 US – Dollar	2,10124	1,94881	2,12240	1,8357
1 Chinesischer Renminbi Yuan	0,25382		0,255680	

# Konzernanhang: Gewinn- und Verlustrechnung

## 1. Umsatzerlöse

Die Erfassung von Umsatzerlösen erfolgt grundsätzlich dann, wenn die Leistung erbracht ist bzw. Waren und Erzeugnisse geliefert worden sind. Die Aufgliederung der Umsatzerlöse sowohl nach Geschäftsbereichen als auch nach regionalen Märkten ist in der folgenden Segmentberichterstattung wiedergegeben.

### Segmentberichterstattung

Entsprechend der Regeln von IAS 14 (Reporting Financial Information by Segment) sind einzelne Jahresabschlussdaten nach Geschäftsbereichen und Regionen segmentiert, wobei sich die Aufgliederung an der internen Berichterstattung orientiert. Durch die Segmentierung sollen Ertragskraft und Erfolgsaussichten der einzelnen Aktivitäten des Konzerns transparent gemacht werden.

Die Geschäftsbereiche umfassen die folgenden Aktivitäten

- Rapid Prototyping umfasst die Weiterentwicklung, Produktion und Vermarktung von Fräsbohrplottern für den Weltmarkt.
- Unter Lasersystemen werden alle Systeme wie Stencil-Laser, MicroLine Laser und sonstige neue Lasertechnologien zusammengefasst.

- Der Geschäftsbereich Schablonen beinhaltet die Aktivitäten der Firmen ELASER und A-Laser, die Stencils für die Leiterbahnenbedruckung herstellen.
- Auf Sonstiges entfallen alle kleineren Aktivitäten wie z.B. die Vermarktung spezieller Softwarepakete in Belgien usw..

Einzelne Tätigkeiten, die keinem Geschäftsbereich zugeordnet werden können, werden in der Spalte „Nicht verteilt“ dargestellt. Innenumsätze zwischen den Segmenten liegen nicht vor.

Die Segmentdaten wurden auf folgende Weise ermittelt:

- Das Segmentergebnis wird unter Einbeziehung der Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte aber ohne Berücksichtigung des Finanzergebnisses sowie der Steuern ermittelt.
- Die Investitionen und Abschreibungen beziehen sich auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte einschließlich Geschäfts- oder Firmenwerte.
- Das betriebliche Segmentvermögen und die Segment-schulden setzen sich aus dem zurechenbaren betriebsnotwendigen Vermögenswerten bzw. dem Fremdkapital ohne verzinsliche Ansprüche und Verbindlichkeiten, Finanzmittel sowie ohne Steuern zusammen.

		Lasersysteme	Rapid Prototyping	Schablonen	Sonstiges	Nicht verteilt	Gesamt
Außenumsatz	2000 TDM	27.785	20.836	3.939	2.201	0	54.761
	1999 TDM	17.178	17.058	3.431	952	0	38.619
Ergebnis	2000 TDM	5.342	4.879	1.216	478	382	12.297
	1999 TDM	3.935	3.012	1.214	194	969	9.324
Vermögen	2000 TDM	23.835	23.258	1.845	0	14.486	63.424
	1999 TDM	16.283	18.467	2.182	0	16.137	53.069
Schulden	2000 TDM	2.589	2.315	160	174	16.909	22.147
	1999 TDM	1.215	2.247	2.657	274	10.395	16.788
Investitionen	2000 TDM	6.494	3.633	35	0	111	10.273
	1999 TDM	2.890	2.607	2.404	0	2.595	10.496
Abschreibungen	2000 TDM	2.027	1.362	474	0	339	4.202
	1999 TDM	990	494	539	0	993	3.016
Sonstige nicht zahlungs-wirksame Aufwendungen	2000 TDM	0	0	0	0	-142	-142
	1999 TDM	0	0	0	0	3	3

		Deutschland	übriges Europa	Nordamerika	Südamerika	Asien	Sonstige	Gesamt
Außenumsatz	2000 TDM	13.978	9.675	15.503	85	14.045	1.475	54.761
	1999 TDM	8.484	8.119	11.386	284	10.065	281	38.619
Vermögen	2000 TDM	46.556	6.947	9.821	0	100	0	63.424
	1999 TDM	40.018	5.685	7.366	0	0	0	53.069
Investitionen	2000 TDM	9.453	653	159	0	8	0	10.273
	1999 TDM	5.692	718	4.086	0	0	0	10.496

Die Vorjahreswerte wurden aus Gründen der Vergleichbarkeit an die aktuellen Zurechnungsgrundlagen angepasst.

## 2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Im Geschäftsjahr wurden gem. IAS 38 im Zusammenhang mit acht Projekten bei der Laserentwicklung (TDM 2.458) und drei Entwicklungsprojekten im Bereich Rapid Prototyping (TDM 184) Entwicklungskosten aktiviert, da die Bedingungen nach IAS 38 kumulativ erfüllt waren.

Die Abschreibung erfolgt über fünf Jahre. Die restlichen aktivierten Eigenleistungen (TDM 190) betreffen Leistungen innerhalb des Konzerns, die in die Aktivierung des Gebäudes geflossen sind.

<b>3. Sonstige betriebliche Erträge (in TDM)</b>	<b>2000</b>	<b>1999</b>
Zuschüsse für Forschung und Entwicklung	929	1.107
Einstellung in den Abgrenzungsposten für Zuwendungen	0	-298
Auflösung Abgrenzungsposten für Zuwendungen	88	24
Erträge aus Kursdifferenzen	1.028	578
Leasing- und Mieterträge	0	114
Inanspruchnahme Garantierückstellungen	255	190
Erträge Auflösung übrige Rückstellungen	7	0
Investitionszuschüsse	123	0
Übrige	298	302
	<b>2.728</b>	<b>2.017</b>

Die Zuschüsse für Forschung und Entwicklung betreffen Zuwendungen der öffentlichen Hand und werden für im Geschäftsjahr angefallene Kosten (Aufwandszuschuss) gewährt. Zuschüsse für aktivierte Entwicklungsaufwendungen aus den Vorperioden, für die ein passiver Abgrenzungsposten gebildet wurde, werden gemäß der Nutzungsdauer periodengerecht aufgelöst. Gleiches gilt für einen Baukostenzuschuss in Suhl in Höhe von TDM 808, der über den Abgrenzungsposten Zuwendungen ebenfalls periodengerecht aufgelöst wird.

<b>4. Materialaufwand (in TDM)</b>	<b>2000</b>	<b>1999</b>
Aufwendungen für (System-) Teile und für bezogene Waren	15.765	8.379
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.407	940
	<b>17.172</b>	<b>9.319</b>

Aus Konsolidierungsgründen wurden in verschiedenen Unternehmen Umgruppierungen vom Materialaufwand zur Bestandsveränderung (Halbfertig- und Fertigwaren) vorgenommen. Hieraus resultiert eine bessere Darstellung von Vorratsvermögen, Waren und Halbfertig-/Fertigwaren auf Konzernebene. Diese ergebnisneutrale Umbuchung führt zu einer rechnerischen Erhöhung der Materialeinsatzquote.

Die Vorjahreswerte wurden aus Vergleichbarkeitsgründen angepasst.

<b>5. Personalaufwand (in TDM) und Mitarbeiter</b>	<b>2000</b>	<b>1999</b>
<b>Löhne und Gehälter</b>		
Gehälter	11.521	8.901
Löhne	1.522	715
Übrige	185	142
	<b>13.228</b>	<b>9.758</b>
<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>		
Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.110	1.420
Berufsgenossenschaft	50	66
Aufwendungen für Altersversorgung	202	144
	<b>2.362</b>	<b>1.630</b>
	<b>15.590</b>	<b>11.388</b>

Die Mitarbeiterzahl setzt sich zum 31. Dezember wie folgt zusammen:	<b>2000</b>	<b>1999</b>
Produktion	53	34
Vertrieb	34	29
Forschung und Entwicklung	34	22
Technik und Verwaltung	65	37
	<b>186</b>	<b>122</b>

Bei LPKF Laser & Electronics AG werden weiterhin zum 31.12.2000 10 Teilzeitkräfte und 5 Auszubildende beschäftigt.

## **6. Abschreibungen**

Die für verschiedene Gruppen des Anlagevermögens vorgenommenen Abschreibungen können dem Anlagenpiegel entnommen werden (10).

<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (in TDM)</b>	<b>2000</b>	<b>1999</b>
Investor Relations	592	380
Werbe- und Vertriebsaufwand	3.425	3.535
Aufsichtsratsvergütungen einschl. Aufwandsersatz	92	90
Forschung und Entwicklung	746	803
Fremdarbeiten	723	1.021
Grundstücks- und Gebäudekosten	55	11
Kraftfahrzeugkosten	230	195
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	392	245
Porto, Telefon, Telefax	421	374
Bürobedarf, Bücher, Software	225	190
Rechts- und Beratungskosten	472	162
Abschluss- und Prüfungskosten	299	86
Patente und Lizenzen	286	258
Miete, Leasing	519	622
Kosten Geldverkehr	277	267
Kursverluste	1.137	243
Verluste Abgang Anlagevermögen	76	56
Geschenke, Bewirtungen, Reisen	1.568	821
Zuführung Wertberichtigung Forderungen	110	0
Übrige	1.416	2.031
	<b>13.061</b>	<b>11.390</b>

Bestehende Leasingverhältnisse, die die Gesellschaft eingegangen ist, werden als Mietleasing-Verhältnisse eingestuft. Die geleisteten Leasingzahlungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung linear über die Laufzeit erfasst. Zu den wesentlichen Verträgen, die unter Leasing aufgeführt sind, gehören hauptsächlich Vereinbarungen über Kraftfahrzeuge und eine Telefonanlage, wobei letztgenannter Vertrag im Geschäftsjahr 2000 ausgelaufen ist. Die Laufzeiten der anderen wesentlichen Verträge betragen noch zwischen 20 und 24 Monate.

<b>8. Finanzergebnis (in TDM)</b>	<b>2000</b>	<b>1999</b>
Erträge aus assoziierten Unternehmen	0	201
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	368	524
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-545	-979
Zinsen Wandelschuldverschreibung		
Barwertveränderung	-3	-4
Zahlung an Zeichner	-25	-17
	<b>-205</b>	<b>-275</b>

<b>9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (in TDM)</b>	<b>2000</b>	<b>1999</b>
Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	4.002	3.112
Gewerbeertragsteuer	1.311	936
latente Steuern	195	381
	<b>5.508</b>	<b>4.429</b>

Die Körperschaftsteuer des Mutterunternehmens für das Jahr 2000 wurde auf der Grundlage der Thesaurierung berechnet, da zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung noch kein Gewinnverwendungsbeschluss vorlag. Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses wurde der individuelle Ertragssteuersatz der betreffenden Länder für die Bewertung der aktiven und passiven latenten Steuern angewandt. Die latenten Steuern wurden nach den Vorgaben des IAS 8 erstmalig zum 01.01.2000 nach der Benchmark-Methode an die jeweiligen landesüblichen Steuersätze angepasst. Die Anpassung wurde erfolgsneutral über die Eröffnungsbilanzwerte vollzogen.

<b>Überleitung vom erwarteten zum tatsächlichen Steueraufwand (in TDM)</b>	<b>2000</b>	<b>1999</b>
Konzernjahresüberschuss vor Ertragssteuern	12.092	9.049
Erwarteter Steueraufwand 39 % · (VJ 38 %)	4.716	3.439
Steuererhöhung aufgrund von Thesaurierung	776	329
Periodenfremder Steueraufwand	0	550
Abweichende Steuersätze von Tochtergesellschaften	18	112
Sonstige Abweichungen	-2	-1
Tatsächlicher Steueraufwand	<b>5.508</b>	<b>4.429</b>

Aufgrund der vorzeitigen Anwendung von IAS 12 (revised 2000) ist der Steueraufwand mit dem Thesaurierungssatz zu bewerten, sofern kein Gewinnverwendungsbeschluss vorliegt.

# Konzernanhang: Konzernbilanz Aktiva

## 10. Anlagevermögen

Konzern-Anlagenspiegel der LPKF Laser & Electronics AG, Garbsen, für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2000. Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens zeigt folgende Übersicht:

	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Stand 31.12.2000 TDM
	Stand 1.1.2000 TDM	Währungs- differenzen TDM	Zugang TDM	Umgliederung TDM	Abgang TDM	
<b>Anlagevermögen</b>						
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
1. Software	720	0	148	0	76	792
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1.722	0	31	0	0	1.753
3. Entwicklungsleistungen	3.368	0	2.642	0	0	6.010
4. Nutzungsrechte	1.542	34	170	0	44	1.702
5. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
	7.352	34	2.991	0	120	10.257
<b>II. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	6.346	123	3.508	3.073	0	13.050
2. technische Anlagen und Maschinen	6.378	112	94	859	1.003	6.440
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.729	78	2.404	-868	918	9.425
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.804	0	1.277	-3.064	17	0
	23.257	313	7.283	0	1.938	28.915
<b>III. Finanzanlagen</b>						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	36	0	0	0	0	36
2. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0	0	22	0	0	22
3. Beteiligungen	0	0	5	0	0	5
4. Sonstige Ausleihungen	7	0	0	0	1	6
	43	0	27	0	1	69
	30.652	347	10.301	0	2.059	39.241

Die aus Unternehmenserwerben resultierenden Geschäfts- oder Firmenwerte (aktive Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung) wurden in Vorperioden aktiviert und werden planmäßig erfolgswirksam über die jeweilige Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte aus dem Erwerb von Unternehmen sind in der Position „Abschreibungen“ enthalten.

Software wird als immaterieller Vermögensgegenstand mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen bewertet.

Die aktivierten Entwicklungsleistungen für acht Laserentwicklungen und drei Entwicklungen im Bereich Rapid

Prototyping werden mit den angefallenen Personal- und Materialkosten bewertet und linear abgeschrieben.

Die Nutzungsrechte werden zu Anschaffungskosten bewertet und linear abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wird mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet. Grund und Boden werden nicht abgeschrieben.

Die Herstellungskosten umfassen die Materialeinzel- und -gemeinkosten, die Fertigungseinzel- und -gemeinkosten, sowie produktionsbezogene anteilige Verwaltungskosten.

<i>Wertberichtigungen</i>					<i>Restbuchwerte</i>		
Stand 1.1.2000 TDM	Währungs- differenzen TDM	Zuführung TDM	Umgliederung TDM	Auflösung TDM	Stand 31.12.2000 TDM	Stand 31.12.2000 TDM	Vorjahr 31.12.1999 TDM
629	0	83	0	51	661	131	91
325	0	339	0	0	664	1.089	1.397
222	0	754	0	0	976	5.034	3.146
427	30	310	0	6	761	941	1.115
0	0	0	0	0	0	0	0
<u>1.603</u>	<u>30</u>	<u>1.486</u>	<u>0</u>	<u>57</u>	<u>3.062</u>	<u>7.195</u>	<u>5.749</u>
915	1	292	0	0	1.208	11.842	5.431
3.773	55	965	571	779	4.585	1.855	2.605
5.538	70	1.459	-571	752	5.744	3.681	3.191
0	0	0	0	0	0	0	1.804
<u>10.226</u>	<u>126</u>	<u>2.716</u>	<u>0</u>	<u>1.531</u>	<u>11.537</u>	<u>17.378</u>	<u>13.031</u>
0	0	0	0	0	0	36	36
0	0	0	0	0	0	22	0
0	0	0	0	0	0	5	0
0	0	0	0	0	0	6	7
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>69</u>	<u>43</u>
<u>11.829</u>	<u>156</u>	<u>4.202</u>	<u>0</u>	<u>1.588</u>	<u>14.599</u>	<u>24.642</u>	<u>18.823</u>

Es werden folgende Nutzungsdauern unterstellt:

	Jahre
Software	3
Geschäfts- oder Firmenwert	5
Entwicklungsleistungen	5
Nutzungsrechte	5
Gebäude	25
Außenanlagen	10
technische Anlagen und Maschinen	3-10
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3-10

Die unter den Finanzanlagen an verbundene Unternehmen ausgewiesene Beteiligung an der Franklin Industries B.V., Niederlande, soll veräußert bzw. liquidiert werden und wurde daher gem. IAS 27.13 (a) nicht in die Konsolidierung einbezogen.

## 11. Vorräte

Die (System-) Teile sowie die Waren werden zu Anschaffungskosten oder zum niedrigeren realisierbaren Nettoverkaufswert am Bilanzstichtag bewertet. Die Herstellungskosten der fertigen und unfertigen Erzeugnisse enthalten Fertigungseinzel- und -gemeinkosten,

Materialeinzel- und -gemeinkosten sowie produktionsbezogene anteilige Verwaltungskosten. Entsprechend der Benchmark-Methode werden bei der Ermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten Fremdkapitalkosten nicht angesetzt.

12. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (in TDM)	2000	1999
Nominalbetrag der Forderungen	14.611	6.118
Einzelwertberichtigung	./. 11	./. 11
Pauschalwertberichtigung	./. 107	./. 31
Forderungsbestand nach Wertberichtigungen	14.493	6.076

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennwert bilanziert worden. Konkrete und latente Ausfallrisiken wurden durch ausreichende Wertberichtigungen berücksichtigt.

13. Sonstige Vermögensgegenstände (in TDM)	2000	1999
kurzfristige Darlehen	0	208
Vorsteuererstattungsanspruch	279	445
Erstattungsanspruch von Ertragssteuern	111	258
Rückdeckungsversicherung	182	150
Ausstehende Zuschüsse für Forschung und Entwicklung	57	410
Übrige	391	194
	1.020	1.665

TDM 182 haben eine Restlaufzeit von über einem Jahr.

## 14. Liquide Mittel

Die liquiden Mittel bestehen aus Kassenbestand TDM 41 (Vorjahr: TDM 18) sowie Guthaben bei Kreditinstituten TDM 7.308 (Vorjahr: TDM 12.857).

Liquide Mittel umfassen für den Zweck der Finanzierungsrechnung Kassenbestände und Bankguthaben, gemindert um die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-

instituten. In der Bilanz erfolgt ein getrennter Ausweis von Vermögensgegenständen und Schulden.

Bei den Wertpapieren handelt es sich um einen Geldmarktfond der Dresdner Bank. Die Bewertung erfolgte mit dem am Abschlussstichtag bestehenden Kurs per Jahresultimo.

## 15. Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Wesentlichen vorausbezahlte Versicherungsbeiträge in Höhe von TDM 233 (Vorjahr: TDM 67).

## 16. Steuerabgrenzungsbetrag

Als aktiver Steuerabgrenzungsbetrag wurden latente Steuern im Wesentlichen aufgrund von Verlustvorträgen, Zwischengewinnen und der Einstellung des Sonderpostens für Zuwendungen gebildet. Aktive wie passive latente Steuern wurden mit dem für die betreffenden

Länder gültigen Thesaurierungssteuersatz berechnet. Die passiven latenten Steuern sind ausschließlich auf aktivierte Entwicklungsleistungen gebildet worden. Die Entwicklung der latenten Steuern stellt sich wie folgt dar:

Aktive latente Steuern (in TDM)	2000	1999
Steuerliche Verlustvorträge	155	116
Sonderposten	87	82
Zwischengewinneliminierung und andere abzugsfähige temporäre Unterschiede	581	177
	823	375

Passive latente Steuern (in TDM)	2000	1999
Aktivierte Eigenleistungen	1.927	944
	1.927	944

## 17. Gezeichnetes Kapital

Gemäß des Hauptversammlungsbeschlusses vom 15.06.2000 erfolgte eine Umstellung des Grundkapitals und anderer DM-Beträge auf EURO, eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, die Neueinteilung des Grundkapitals sowie die Anpassung und Änderung des bedingten Kapitals und diesbezügliche Satzungsänderung.

Darüber hinaus wurde die Ermächtigung des Vorstandes, in der Zeit bis 13. Oktober 2003 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats zu erhöhen (genehmigtes Kapital) aufgehoben. Stattdessen wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um bis zu EUR 5.250.000 (genehmigtes Kapital) durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 5.250.000 neuen Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage bis zum 14. Juni 2005 zu erhöhen.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nach dem im Verhältnis 1:4 durchgeführten Aktiensplitt und der Kapitalerhöhung von DM 10.036.215,00 aus der Kapitalrücklage

DM 20.536.215,00 (EUR 10.500.000) und ist eingeteilt in 10.500.000 Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil von je EUR 1,00.

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2000 wurde dem Vorstand der LPKF Laser & Electronics AG die Möglichkeit eingeräumt, eigene Aktien über die Börse zurückzukaufen. Der Rückkauf der Aktien dient der Finanzierung eines Mitarbeiterbeteiligungsmodells, um bewährte Mitarbeiter noch stärker an das Unternehmen zu binden. Die Gesellschaft ist ermächtigt bis zum 14.12.2001 eigene Aktien bis zu 10 % des derzeitigen Grundkapitals über die Börse zu erwerben. Der Erwerbspreis pro Aktie darf den maßgeblichen Börsenkurs um nicht mehr als 5 % über- oder unterschreiten. Als maßgeblicher Börsenkurs im Sinne der vorstehenden Regelung gilt dabei der Mittelwert der an der Frankfurter Wertpapierbörse im Xetra-Handel festgestellten Schlusskurse der Aktien während der letzten fünf Börsentage vor dem Erwerb der Aktien.

## 18. Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage wurde in Höhe von DM 10.036.215,00 verwendet, um die durch die Hauptversammlung vom 15.06.2000 beschlossene Umstellung des Grundkapitals und die damit verbundene Kapitalerhöhung durchzu-

führen. Sie resultiert aus dem gezahlten Aufgeld bei der Ausgabe von Aktien der Muttergesellschaft aus dem Jahr des Börseneintritts sowie dem Optionspreis der Wandelschuldverschreibung aus dem Vorjahr.

## 19. Genehmigtes Kapital/bedingtes Kapital

Das bedingte Kapital wurde gemäß § 218 AktG dahingehend angepasst, dass das Grundkapital um bis zu EUR 500.000 bedingt erhöht ist. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber der Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13. Oktober 1998 ausgegeben wurden, von ihren Wandlungsrechten auf Umtausch in neue Aktien Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungsrechten entstehen, am Gewinn teil. Je DM 5,00 Nennbetrag Schuldverschreibungen berechtigen den Inhaber bei Ausübung des Wandlungsrechts zum Erwerb von 5 Stückaktien der LPKF Laser & Electronics AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der

LPKF Laser & Electronics AG von EUR 5,00. Der Wandlungspreis zum Erwerb einer solchen Stückaktie wird nach einer Formel berechnet, die auf einem Vergleich der Wertentwicklung der LPKF Aktie zum Deutschen Aktienindex (DAX) basiert. Im Falle der Ausübung des Wandlungsrechts ist für den Erwerb einer Stückaktie eine Barzahlung in Höhe des Betrages zu leisten, um den der Wandlungspreis den anteiligen Nennbetrag der umzutauschenden Schuldverschreibung übersteigt. Die Laufzeit der Wandelanleihe beträgt 5 Jahre (Laufzeitende 29. Dezember 2003) mit einer jährlichen Verzinsung vom 5 %. Wandlung ist frühestens nach der ordentlichen Hauptversammlung im Geschäftsjahr 2001 möglich. Zur Ermittlung des Eigenkapitals wurde die Barwertmethode angewendet.

## 20. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter (in TDM)

Der Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter an Tochtergesellschaften entwickelte sich wie folgt:

	2000	1999
Stand 1. Januar	2.163	902
Ab- / Zugänge	390	1.261
Stand 31. Dezember	2.553	2.163

Die Veränderungen resultieren aus dem auf fremde Gesellschafter entfallenden Anteil am Jahresergebnis des Konzerns, Veränderungen ergeben sich aufgrund der Währungsumrechnung und aus Maßnahmen der Erstkonsolidierung, sowie aus Auszahlungen an andere Gesellschafter.

## 21. Rückstellungen für Pensionen

In Deutschland besteht eine beitragsorientierte gesetzliche Grundversorgung der Arbeitnehmer, die Rentenzahlungen in Abhängigkeit vom Einkommen und den geleisteten Beiträgen übernimmt. Demgegenüber bestehen im Ausland leistungsorientierte Versorgungszusagen, die von den rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des jeweiligen Landes abhängig sind und in der Regel auf Beschäftigungsdauer und -entgelt der Mitarbeiter basieren.

Die ausgewiesenen Pensionsrückstellungen beinhalten leistungsorientierte Pensionszusagen an die Vorstände der Muttergesellschaft.

Die Berechnung erfolgte nach dem international üblichen Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit Methode).

Die Berechnung der Pensionsverpflichtung bei der deutschen Muttergesellschaft erfolgte auf Grundlage der „Richtlinien“ von Dr. Klaus Heubeck, wobei künftige Rentenanpassungen mit 2 % berücksichtigt wurden. Der Abzinsungsfaktor beträgt 7 %.

## 22. Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen

Rückstellungen werden für rechtliche oder effektive Verpflichtungen gebildet, die ihren Ursprung in der Vergangenheit haben, wenn es wahrscheinlich ist, dass die

Erfüllung der Verpflichtung zu einem Abfluss von Konzernressourcen führt und eine zuverlässige Schätzung der Verpflichtungshöhe vorgenommen werden kann.

<i>Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen (in TDM)</i>	<i>2000</i>	<i>1999</i>
Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	1.752	1.337
Gewerbesteuer	845	252
Sonstige Steuern	120	0
	<b>2.717</b>	<b>1.589</b>
Tantieme	625	549
Garantien	234	358
Urlaub	316	244
Jahresabschlusskosten	245	78
Rechts- und Beratungskosten	152	0
Berufsgenossenschaft	44	44
Übrige	196	57
	<b>1.812</b>	<b>1.330</b>

### Rückstellungsspiegel

Rückstellungen In TDM	Stand 01.01.2000	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2000
Rückstellungen für Pensionen	362	-	-	12	374
Steuerrückstellungen	1.589	1.337	-	2.465	2.717
Tantieme	549	549	-	625	625
Urlaub	244	244	-	316	316
Garantie	358	255	103	234	234
Übrige	179	179	-	637	637
<b>Total</b>	<b>3.281</b>	<b>2.564</b>	<b>103</b>	<b>4.289</b>	<b>4.903</b>

## 23. Verbindlichkeiten

Die Gliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten ergibt sich aus dem nachfolgend dargestellten Verbindlichkeitspiegel:

### Verbindlichkeitspiegel (in TDM) mit einer Restlaufzeit von

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	gesicherte Beträge	Art der Sicherheit
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.226 (3.310)	658 (287)	2.018 (780)	3.550 (2.243)	6.095 (3.057)	* (*)
Wandelschuldverschreibung	485 (482)	485 (-)	- (482)	- (-)	- (-)	- (-)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.538 (2.094)	2.538 (2.094)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	35 (-)	35 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
Verbindlichkeiten gg. Untern. mit Beteiligungsverhältnis	27 (-)	27 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
sonstige Verbindlichkeiten	1.761 (3.844)	1.761 (3.844)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	11.072 (9.730)	5.504 (6.225)	2.018 (1.262)	3.550 (2.243)	6.095 (3.057)	

\* Grundschuld

Weitere Angaben zu den Verbindlichkeiten: Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten Darlehen in Höhe von TDM 6.226, deren Verzinsung sich auf 3,75 % p.a. bis 6,25 % p.a. beläuft.

Original-Darlehen in TDM	Zinssatz p.a.	Laufzeit
113	6,25 %	01/98 – 12/01
121	4,50 %	09/99 – 09/04
1.286	3,75 %	09/99 – 09/14
2.250	5,85 %	09/99 – 09/09
3.100	5,41 %	01/00 – 09/09

## 24. Anleihe

Bei der Anleihe handelt es sich um eine Wandelschuldverschreibung, die unter der Tz 19 erläutert wird. Die Ermittlung des Eigenkapitalanteils erfolgte anhand der Barwertmethode. Die Abzinsung wurde zu einem marktüblichen Zinssatz vorgenommen.

## 25. Steuerabgrenzungsbetrag

Als passiver Steuerabgrenzungsbetrag wurden latente Steuern aufgrund der Aktivierung von Entwicklungsleistungen ausgewiesen. Die latenten Steuern wurden mit dem Steuersatz der individuellen Vorgaben der einzelnen Länder berechnet (vgl. Tz 16).

## Sonstige Angaben

### 26. Kapitalflussrechnung

In dem Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit sind Steuerzahlungen in Höhe von TDM 2.790 (Vorjahr: TDM 2.961) sowie Zinsausgaben von TDM 525 (Vorjahr: TDM 999) und Zinseinnahmen in Höhe von TDM 368 (Vorjahr: TDM 523) enthalten.

## 27. Gewinn pro Aktie

Das unverwässerte Ergebnis je Aktie wird gemäß IAS 33 als Quotient aus dem den Aktionären der LPKF Laser & Electronics AG zustehenden Konzernjahresüberschuss und der Anzahl der während des Geschäftsjahres in Umlauf befindlichen Aktien ermittelt. Eine Verwässerung des Ergebnisses je Aktie tritt dann ein, wenn die durchschnitt-

liche Aktienanzahl durch Hinzurechnung der Ausgabe potenzieller Aktien aus der von der LPKF Laser & Electronics AG begebenen Wandelschuldverschreibung erhöht wird. Wandelschuldverschreibungen wirken grundsätzlich ergebnisverwässernd.

	2000	1999
Aktienanzahl unverwässert	10.500.000	10.500.000 *)
Aktienanzahl verwässert	11.000.000	11.000.000 *)
Konzernergebnis (in TDM)	6.226	4.408
Eliminierung von Zinsaufwand für Wandelschuldverschreibung	25	17
Eliminierung des Steuereffekts auf die Zinsaufwendungen der Wandelschuldverschreibung	-10	-7
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in DM)	0,59	0,42
Verwässertes Ergebnis je Aktie (in DM)	0,57	0,40

\*) Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurde für das Vorjahr ein entsprechendes Optionsrecht, sowie der Aktiensplitt für die Aktienanzahl unterstellt.

## 28. Dividende je Aktie

Ausschüttungen werden erst nach Beschluss der Hauptversammlung als Gewinnverwendung berücksichtigt. Bei der Hauptversammlung am 17.05.2001 wird eine Divi-

dende für das Jahr 2000 in Höhe von DM 0,12 je Aktie vorgeschlagen. Diese Dividende wird als Gewinnverwendung erst im Jahresabschluss 2001 berücksichtigt.

## 29. Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen

Nahestehende Unternehmen	TDM
Zeltra Naklo d.o.o., Slowenien, bezogene Lieferungen und Leistungen	203
PMV d.o.o., Slowenien, bezogene Leistungen	521

Die Zeltra Naklo d.o.o. wird zu 80 % von einem Geschäftsführer und Gesellschafter sowie zu 20 % von einem leitenden Angestellten und Gesellschafter eines Tochterunternehmens gehalten. In 2000 wurden von diesem nahestehenden Unternehmen Material- und Anlagenlieferungen, Handelswaren sowie Dienstleistungen in Höhe von TDM 203 bezogen.

Die PMV d.o.o. wird zu 50 % von einem Geschäftsführer und Gesellschafter eines Tochterunternehmens gehalten.

Die Geschäftsbeziehungen umfassten in 2000 Entwicklungs- und Fertigungsleistungen sowie Vermietungen und betragen TDM 521.

Ein Mitglied des Aufsichtsorgans erbrachte in 2000 Rechtsberatungsleistungen in Höhe von TDM 55.

Außerdem wurden zwei nahe Familienangehörige von Mitgliedern der Unternehmensleitung des Mutterunternehmens im Angestelltenverhältnis beschäftigt.

## 30. Sonstige Angaben

### Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Laserquipment AG wird zum Geschäftsjahresbeginn 2001 ein Darlehen in Höhe von DM 117.600 gewährt. Nach Maßgabe einer Business-Planverpflichtung sind weitere Zahlungen von insgesamt DM 705.530 geplant, die nach Erreichen festgesetzter Meilensteine in Eigenkapital umgewandelt werden.

### Sonstiges

Die Voraussetzungen gemäß § 292a HGB für die Befreiung der LPKF Laser & Electronics AG von der Erstellung eines Konzernjahresabschlusses nach deutschen Rechnungslegungsnormen sind erfüllt. Der Konzernabschluss steht

entsprechend der Auslegung gemäß DRS 1 des Deutschen Rechnungslegung Standards Committee insbesondere im Einklang mit der Richtlinie der Europäischen Union zur Konzernrechnungslegung (Richtlinie 83/349/EWG). Es haben sich folgende von deutschen handelsrechtlichen Vorschriften abweichende Bilanzierungs-, Bewertungs- und Konsolidierungsmethoden ergeben:

- Aktivierung von Entwicklungskosten
- Bilanzierung der Wandelschuldverschreibung zum Barwert
- Aktivierung von latenten Steuern auf Verlustvorträge

Die Befreiung von Pflichten zur Aufstellung eines handelsrechtlichen Konzernabschlusses ist für die LPKF Laser & Electronics AG somit gegeben.

## Als Vorstände der Gesellschaft sind bestellt:

Bernd Hildebrandt · Vorsitzender ·  
Dipl.-Ing. Bernd Hackmann  
Dipl.-Ing. Dr. Jörg Kickelhain

## Aufsichtsratsmitglieder sind:

Klaus Sülter  
Generalbevollmächtigter Cura Consult GmbH  
· Vorsitzender ·  
Dr. Heino Büsching  
Rechtsanwalt/Steuerberater  
ISR AG, Braunschweig · Vorsitzender Aufsichtsrat  
· stellvertretender Vorsitzender ·  
Udo B. Hartmann  
Kaufmann

Die Vergütung des Vorstandes belief sich auf insgesamt TDM 1.936 (TDM 1.845). Zum 31.12.2000 wurden von Vorstandsmitgliedern 1.142.100 (1.327.500) Aktien gehalten.

Die Vergütung des Aufsichtsrates belief sich auf insgesamt TDM 92 (TDM 90). Zum 31.12.2000 wurden von Aufsichtsratsmitgliedern 924.500 (1.039.500) Aktien gehalten.

Vorstand und Aufsichtsrat des Mutterunternehmens schlugen vor, eine Dividende in Höhe von DM 0,12 pro Aktie auszuschütten und den verbleibenden Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. Der Gewinnverwendungsvorschlag hat nicht zu einer Verbindlichkeit geführt.

## 31. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Zur Durchführung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms kaufte die LPKF Laser & Electronics AG 5.000 eigene Aktien zu einem Wert von DM 260.125,39 zurück.

LPKF Laser & Electronics AG · Garbsen/Hannover, 16. Februar 2001

gez. Bernd Hildebrandt

gez. Bernd Hackmann

gez. Dr. Jörg Kickelhain

## Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Konzernabschluss der LPKF Laser & Electronics AG, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalflussrechnung und Anhang, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2000 geprüft. Aufstellung und Inhalt des Konzernabschlusses nach den International Accounting Standards des IASC (IAS) liegen in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung zu beurteilen, ob der Konzernabschluss den IAS entspricht.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach den deutschen Prüfungsvorschriften und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob der Konzernabschluss frei von wesentlichen Fehlaussagen ist. Im Rahmen der Prüfung werden die Nachweise für die Wertansätze und Angaben im Konzernabschluss auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzung des Vorstands sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Nach unserer Überzeugung auf der Grundlage unserer Prüfung vermittelt der Konzernabschluss in Übereinstimmung mit den IAS ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns sowie der Zahlungsströme des Geschäftsjahres.

Unsere Prüfung, die sich nach den deutschen Prüfungsvorschriften auch auf den vom Vorstand aufgestellten Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2000 erstreckt hat, hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Überzeugung gibt der Konzernlagebericht insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Konzerns und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. Außerdem bestätigen wir, dass der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2000 die Voraussetzungen für eine Befreiung der Gesellschaft von der Aufstellung eines Konzernabschlusses und Konzernlageberichts nach deutschem Recht erfüllen.

Hannover, 2. März 2001  
SOCIETÄTS TREUHAND GRUPPE GMBH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

T. Stieve  
Wirtschaftsprüfer

Dr. M. Schellhorn  
Wirtschaftsprüfer

# Jahresabschluss der LPKF Laser & Electronics AG

	31.12.2000	31.12.1999
<b>Aktiva</b>	<b>TDM</b>	<b>TDM</b>
<b>Anlagevermögen</b>		
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Software	75	43
Nutzungsrechte	105	140
	<u>180</u>	<u>183</u>
<b>Sachanlagen</b>		
Grundstücke, grundstücksgl. Rechte und Bauten	7.826	3.744
technische Anlagen und Maschinen	756	1.411
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.156	1.700
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	781
	<u>10.738</u>	<u>7.636</u>
<b>Finanzanlagen</b>		
Anteile an verbundenen Unternehmen	2.428	1.303
Ausleihungen an verb. Unternehmen	1.024	769
Beteiligungen	27	0
	<u>3.479</u>	<u>2.072</u>
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>14.397</b>	<b>9.891</b>
<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>Vorräte</b>		
(System-) Teile	77	40
fertige Erzeugnisse und Waren	9.608	8.947
geleistete Anzahlungen	1.640	670
	<u>11.325</u>	<u>9.657</u>
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.514	3.711
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.063	2.805
Sonstige Vermögensgegenstände	241	1.042
	<u>17.818</u>	<u>7.558</u>
<b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>3.383</b>	<b>10.424</b>
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>32.526</b>	<b>27.639</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>124</b>	<b>25</b>
<b>Total Aktiva</b>	<b>47.047</b>	<b>37.555</b>

# Jahresabschluss der LPKF Laser & Electronics AG

Grußwort des Vorsitzenden  
 Bericht des Aufsichtsrates  
 Lagebericht des Konzerns  
 Wachstumsmarkt Elektronik  
 Tagebuch einer Innovation  
 Gewinn- + Verlustrechnung  
 Konzernbilanz  
 Kapitalflussrechnung  
 Konzernanhang

	31.12.2000	31.12.1999
<i>Passiva</i>	TDM	TDM
<b><i>Eigenkapital</i></b>		
Gezeichnetes Kapital	20.536	10.500
Kapitalrücklage	7.085	17.121
Gewinnvortrag	3.204	1.534
Jahresüberschuss	3.857	2.720
	<u>34.682</u>	<u>31.875</u>
<b><i>Rückstellungen</i></b>		
Rückstellungen für Pensionen	380	345
Steuerrückstellungen	1.692	399
Sonstige Rückstellungen	1.482	983
	<u>3.554</u>	<u>1.727</u>
<b><i>Verbindlichkeiten</i></b>		
Anleihe (davon konvertibel TDM 499)	499	500
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.793	1.937
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	942	631
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.096	423
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	27	0
Sonstige Verbindlichkeiten	454	462
(davon aus Steuern TDM 170)		
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit TDM 203)		
	<u>8.811</u>	<u>3.953</u>
<b><i>Total Passiva</i></b>	<b><i>47.047</i></b>	<b><i>37.555</i></b>

Jahresabschluss 2000

# Jahresabschluss der LPKF Laser & Electronics AG

01.01.-31.12.2000 01.01.-31.12.1999

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	TDM	TDM
Umsatzerlöse	44.649	32.140
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-936	756
andere aktivierte Eigenleistungen	0	133
sonstige betriebliche Erträge	1.838	2.032
	45.551	35.061
Materialaufwand	18.337	13.656
Personalaufwand	9.292	8.095
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.640	1.380
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	3
sonstige betriebliche Aufwendungen	9.135	7.585
Betriebsergebnis	7.147	4.342
Erträge aus Beteiligungen	171	175
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	143	444
an Organgesellschaft weiterbelastete Gewerbesteuerumlage	34	109
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	346	451
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-314	-352
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.527	5.169
Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.533	2.436
Sonstige Steuern	137	13
Jahresüberschuss	3.857	2.720
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	3.204	1.534
Bilanzgewinn	7.061	4.254

## **Impressum**

### **Herausgeber**

LPKF Laser & Electronics AG  
Osteriede 7  
D-30827 Garbsen  
Telefon: +49 (0) 5131-70 95-0  
Telefax: +49 (0) 5131-70 95-90  
e-mail: [lpkf@lpkf.de](mailto:lpkf@lpkf.de)  
web info: [www.lpkf.de](http://www.lpkf.de)

### **Konzept, Gestaltung und Realisation**

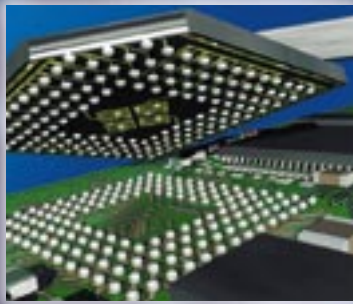
Hering Werbeagentur GmbH, Bückeburg  
Telefon: +49 (0) 5722-2 50 95  
Telefax: +49 (0) 5722-2 29 65  
e-mail: [agentur@hering.de](mailto:agentur@hering.de)  
Internet: [www.hering.de](http://www.hering.de)

### **Koordination und Redaktion**

Peter Kirch Communications, Hannover  
Telefon: +49 (0) 511-8 56 54-0  
e-mail: [info@kirch.de](mailto:info@kirch.de)  
Internet: [www.kirch.de](http://www.kirch.de)

### **Auflage**

5.000 Deutsch  
2.000 Englisch



Einen Schritt voraus ...





Laser & Electronics



LPKF Laser & Electronics AG

Osteriede 7

D-30827 Garbsen

Telefon +49(0) 51 31-7095-0

Telefax +49(0) 51 31-7095-90

Internet [www.lpkf.de](http://www.lpkf.de)

E-Mail [lpkf@lpkf.de](mailto:lpkf@lpkf.de)

